

14ビット・ ダイレクトコンバージョン・ レシーバ・サブシステム

特長

- デュアル14ビット高速ADC、ローパス・フィルタ、差動利得段、I/Q 復調器を内蔵
- ADCチャンネルごとのローパス・フィルタ
1.92MHz (LTM9004-AA)
4.42MHz (LTM9004-AB)
9.42MHz (LTM9004-AC)
20MHz (LTM9004-AD)
- RF入力周波数範囲: 0.7GHz ~ 2.7GHz
- 50ΩのシングルエンドRFおよびLOポート
- I/Q 利得ミスマッチ: 標準 0.2dB
- I/Q 位相ミスマッチ: 標準 1.5°
- 復調器のDCオフセットを電圧で調整可能
- SNR: 76dB/1.92MHz (LTM9004-AA)
- SFDR: 63.5dB (LTM9004-AA)
- クロック・デューティ・サイクル・スタビライザ
- 低消費電力: 1.83W
- シャットダウン・モードとナップ・モード
- 15mm×22mm LGAパッケージ

アプリケーション

- 通信機器
- ダイレクトコンバージョン・レシーバ
- セルラー基地局

概要

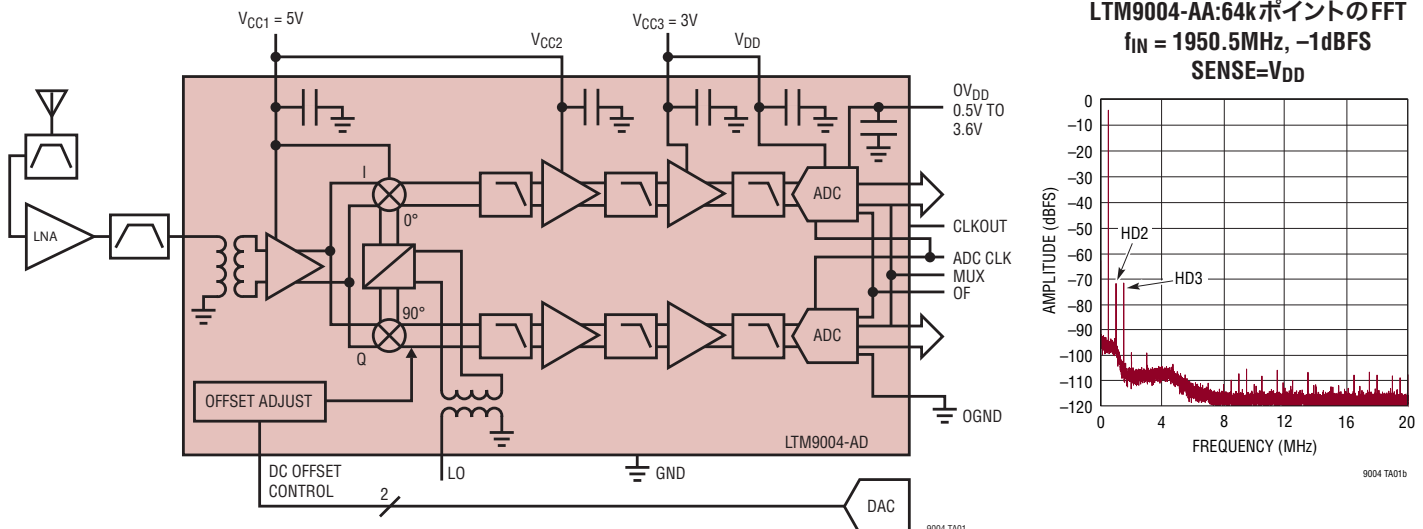
LTM[®]9004は14ビット、ダイレクトコンバージョン・レシーバ・サブシステムです。μModule[®]レシーバであるLTM9004は、集積化システム・イン・パッケージ (SiP) 技術を利用し、デュアル高速14ビットA/Dコンバータ、ローパス・フィルタ、差動利得段、直交復調器を内蔵しています。カスタム対応については、弊社にお問い合わせください。

LTM9004はゼロIFの通信アプリケーションに最適で、SNRが76dB、SFDRが63.5dBという優れたAC特性を備えています。シグナル・チェーン全体がDC結合されており、DCオフセットを調整する機能を搭載しています。RF入力とLO入力には広帯域トランスを搭載し、50Ωのシングルエンド・インタフェースを提供します。

5V電源がミキサと第1アンプに電力を供給するので、歪みを最小限に抑えることができます。また、3V電源が低消費電力のADC動作を可能にします。独立した電源により、出力が0.5V ~ 3.3Vのロジックをドライブできます。オプションのマルチプレクサにより、2つのチャンネルが1つのデジタル出力バスを共用できます。また、オプションのクロック・デューティ・サイクル・スタビライザにより、広範なクロック・デューティ・サイクルにわたって最高速度で高性能を発揮できます。

LT、LT、LTC、LTM、Linear TechnologyおよびLinearのロゴはリニアテクノロジー社の登録商標です。μModuleはリニアテクノロジー社の登録商標です。他の全ての商標はそれぞれの所有者に所有権があります。

標準的応用例



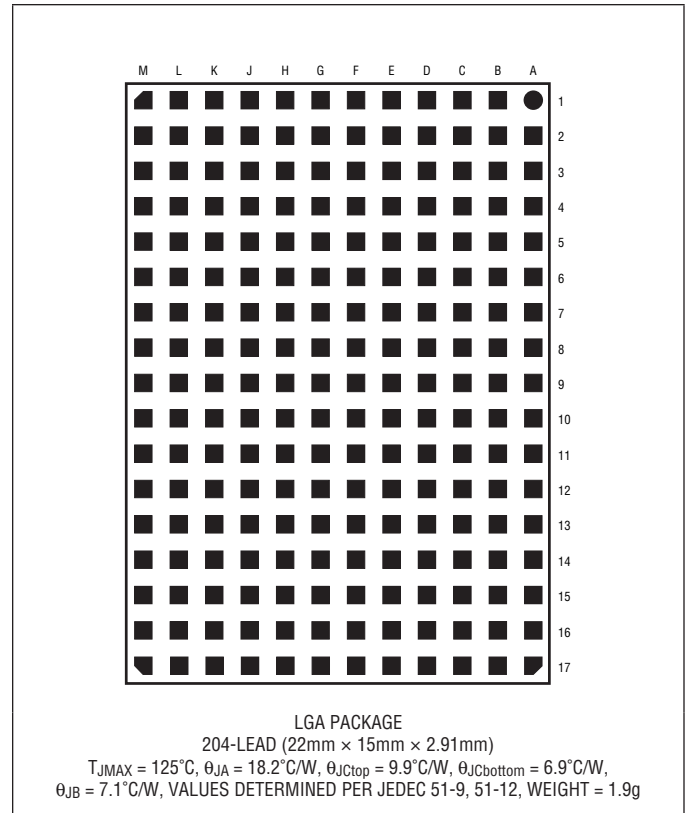
LTM9004

絶対最大定格

(Note 1, 2)

電源電圧 (V_{CC1} , V_{CC2})	-0.3V ~ 5.5V
電源電圧 (V_{CC3} , LTM9004-AA, LTM9004-AB)	-0.3V ~ 5.5V
電源電圧 (V_{CC3} , LTM9004-AC, LTM9004-AD)	-0.3V ~ 3.5V
電源電圧 (V_{DD} , $0V_{DD}$)	-0.3V ~ 4.0V
デジタル出力のグランド電圧 ($0GND$)	-0.3V ~ 1V
L0 入力電力	10dBm
RF 入力電力	20dBm
RF 入力の DC 電圧	$\pm 0.1V$
L0 入力の DC 電圧	$\pm 0.1V$
x_ADJ の入力電圧	-0.3V ~ V_{CC1} , V_{CC2}
SENSE 入力の電圧	-0.3V ~ V_{DD}
デジタル入力電圧 (MIXENABLE)	-0.3V ~ ($V_{CC1} + 0.3V$)
デジタル入力電圧 (AMP1ENABLE)	-0.3V ~ ($V_{CC2} + 0.3V$)
デジタル入力電圧 (AMP2ENABLE)	-0.3V ~ ($V_{CC3} + 0.3V$)
デジタル入力電圧 (MIXENABLE と AMPxENABLE を除く)	...	-0.3V ~ ($V_{DD} + 0.3V$)
デジタル出力電圧	-0.3V ~ ($0V_{DD} + 0.3V$)
動作温度範囲		
LTM9004C	0°C ~ 70°C
LTM9004I	-40°C ~ 85°C
保存温度範囲	-65°C ~ 125°C

ピン配置



注意: このデバイスは静電気放電 (ESD) に敏感です。
LTM9004 の RF 入力と L0 入力を扱うときは適切な ESD 対策
をとることが非常に重要です。

発注情報

無鉛仕上げ	トレイ	製品マーキング*	パッケージ	温度範囲
LTM9004CV-AA#PBF	LTM9004CV-AA#PBF	LTM9004V AA	204-Lead (15mm × 22mm × 2.91mm) LGA	0°C to 70°C
LTM9004IV-AA#PBF	LTM9004IV-AA#PBF	LTM9004V AA	204-Lead (15mm × 22mm × 2.91mm) LGA	-40°C to 85°C
LTM9004CV-AB#PBF	LTM9004CV-AB#PBF	LTM9004V AB	204-Lead (15mm × 22mm × 2.91mm) LGA	0°C to 70°C
LTM9004IV-AB#PBF	LTM9004IV-AB#PBF	LTM9004V AB	204-Lead (15mm × 22mm × 2.91mm) LGA	-40°C to 85°C
LTM9004CV-AC#PBF	LTM9004CV-AC#PBF	LTM9004V AC	204-Lead (15mm × 22mm × 2.91mm) LGA	0°C to 70°C
LTM9004IV-AC#PBF	LTM9004IV-AC#PBF	LTM9004V AC	204-Lead (15mm × 22mm × 2.91mm) LGA	-40°C to 85°C
LTM9004CV-AD#PBF	LTM9004CV-AD#PBF	LTM9004V AD	204-Lead (15mm × 22mm × 2.91mm) LGA	0°C to 70°C
LTM9004IV-AD#PBF	LTM9004IV-AD#PBF	LTM9004V AD	204-Lead (15mm × 22mm × 2.91mm) LGA	-40°C to 85°C

さらに広い動作温度範囲で規定されるデバイスについては、弊社または弊社代理店にお問い合わせください。* 温度グレードは出荷時のコンテナのラベルで識別されます。

無鉛仕上げの製品マーキングの詳細については、<http://www.linear-tech.co.jp/leadfree/> をご覧ください。

この製品はトレイでのみ供給されます。詳細については、<http://www.linear-tech.co.jp/packaging/> をご覧ください。

電気的特性

● は全動作温度範囲の規格値を意味する。それ以外は $T_A = 25^\circ\text{C}$ での値。注記がない限り、 $V_{CC1} = V_{CC2} = 5\text{V}$ 、 $V_{DD} = 0\text{V}$ 、 $V_{DD} = 3\text{V}$ 、 $V_{CC3} = 3\text{V}$ (LTM9004-AC、LTM9004-AD)、 $V_{CC3} = 5\text{V}$ (LTM9004-AA、LTM9004-AB)、 $P_{LO} = 0\text{dBm}$ 。(Note 3)

SYMBOL	PARAMETER	CONDITIONS	MIN	TYP	MAX	UNITS
	RF Input Frequency Range	No External Matching (High Band) With External Matching (Low Band, Mid Band)		1.5 to 2.7 0.7 to 1.5		GHz GHz
	LO Input Frequency Range	No External Matching (High Band) With External Matching (Low Band, Mid Band)		1.5 to 2.7 0.7 to 1.5		GHz GHz
	Baseband Frequency Range	LTM9004-AA LTM9004-AB LTM9004-AC LTM9004-AD		DC to 1.92 DC to 4.42 DC to 9.42 DC to 20		MHz MHz MHz MHz
	RF Input Return Loss	$Z_0 = 50\Omega$, 1.5GHz to 2.7GHz, Internally Matched		>10		dB
	LO Input Return Loss	$Z_0 = 50\Omega$, 1.5GHz to 2.7GHz, Internally Matched		>10		dB
	RF Input Power for -1dBFS	RF = 1950MHz		-7.3		dBm
	LO Input Power			-13 to 5		dBm
	I/Q Gain Mismatch			0.2		dB
	I/Q Phase Mismatch			1.5		Deg
	LO to RF Leakage	RF = 900MHz RF = 1900MHz		-60.8 -64.6		dBm dBm
	RF to LO Isolation	RF = 900MHz RF = 1900MHz		59.7 57.1		dB dB
	Maximum DC Offset Voltage, No RF	(Note 5)		35		mV
	DC Offset Variation	-40°C to 85°C		210		$\mu\text{V}/^\circ\text{C}$
	Gain Flatness	DC to 1.92MHz (LTM9004-AA) DC to 4.42MHz (LTM9004-AB) DC to 9.42MHz (LTM9004-AC) DC to 20MHz (LTM9004-AD)		0.2 0.2 0.2 0.3		dB dB dB dB
	Group Delay Flatness	DC to 1.92MHz (LTM9004-AA) DC to 4.42MHz (LTM9004-AB) DC to 9.42MHz (LTM9004-AC) DC to 20MHz (LTM9004-AD)		15 15 15 5		nsec nsec nsec nsec
	Rejection	LTM9004-AA 5MHz 10MHz		5.3 33.5		dB dB
		LTM9004-AB 7.5MHz 12.5MHz		1 11		dB dB
		LTM9004-AC 12.5MHz 17.5MHz		0.5 1		dB dB
		LTM9004-AD 30MHz 40MHz		1.5 5.5		dB dB
f_{LPF}	Lowpass Filter Cutoff Frequency	1dB Point (LTM9004-AA) 1dB Point (LTM9004-AB) 1dB Point (LTM9004-AC) 1dB Point (LTM9004-AD)		4 6.3 15 28		MHz MHz MHz MHz

LTM9004

ダイナミック精度

● は全動作温度範囲の規格値を意味する。それ以外は $T_A = 25^\circ\text{C}$ での値。注記がない限り、 $V_{CC1} = V_{CC2} = 5\text{V}$ 、 $V_{DD} = 0\text{V}$ 、 $V_{DD} = 3\text{V}$ 、 $V_{CC3} = 3\text{V}$ (LTM9004-AC、LTM9004-AD)、 $V_{CC3} = 5\text{V}$ (LTM9004-AA、LTM9004-AB)、 $P_{LO} = 0\text{dBm}$ 。

SYMBOL	PARAMETER	CONDITIONS	MIN	TYP	MAX	UNITS
IIP3	Input 3rd-Order Intercept, 1 Tone			22		dBm
IIP2	Input 2nd-Order Intercept, 1 Tone			58		dBm
SNR	Signal-to-Noise Ratio at -1dBFS	1.92MHz (LTM9004-AA) 4.42MHz (LTM9004-AB) 9.42MHz (LTM9004-AC) 20MHz (LTM9004-AD)	● ● ● ●	70.6 69.7 70.3 66.3	76.1 75.2 72 68.9	dB/1.92MHz dB/4.42MHz dB/9.42MHz dB/20MHz
SFDR	Spurious Free Dynamic Range 2nd or 3rd Harmonic at -1dBFS	LTM9004-AA RF = 1950.5MHz, LO = 1950MHz	●	50	63.5	dB
		LTM9004-AB RF = 1951MHz, LO = 1950MHz	●	50	65	dB
		LTM9004-AC RF = 1952.5MHz, LO = 1950MHz	●	52.5	66	dB
		LTM9004-AD RF = 1955MHz, LO = 1950MHz	●	55	64	dB
SFDR	Spurious Free Dynamic Range 4th or Higher at -1dBFS	LTM9004-AA RF = 1950.5MHz, LO = 1950MHz	●	65	88	dB
		LTM9004-AB RF = 1951MHz, LO = 1950MHz	●	70	91	dB
		LTM9004-AC RF = 1952.5MHz, LO = 1950MHz	●	70	89	dB
		LTM9004-AD RF = 1955MHz, LO = 1950MHz	●	70	89	dB
S/(N+D)	Signal-to-Noise Plus Distortion Ratio at -1dBFS	LTM9004-AA RF = 1950.5MHz, LO = 1950MHz	●	51.5	58.5	dB
		LTM9004-AB RF = 1951MHz, LO = 1950MHz	●	51.5	60	dB
		LTM9004-AC RF = 1952.5MHz, LO = 1950MHz	●	53	61	dB
		LTM9004-AD RF = 1955MHz, LO = 1950MHz	●	53	60	dB
HD2	2nd Order Harmonic Distortion Ratio at -1dBFS	LTM9004-AA RF = 1950.5MHz, LO = 1950MHz			64	dB
		LTM9004-AB RF = 1951MHz, LO = 1950MHz			66	dB
		LTM9004-AC RF = 1952.5MHz, LO = 1950MHz			66	dB
		LTM9004-AD RF = 1955MHz, LO = 1950MHz			64	dB
HD3	3rd Order Harmonic Distortion Ratio at -1dBFS	LTM9004-AA RF = 1950.5MHz, LO = 1950MHz			69	dB
		LTM9004-AB RF = 1951MHz, LO = 1950MHz			66	dB
		LTM9004-AC RF = 1952.5MHz, LO = 1950MHz			67	dB
		LTM9004-AD RF = 1955MHz, LO = 1950MHz			67	dB

9004fa

コンバータ特性

●は全動作温度範囲の規格値を意味する。それ以外は $T_A = 25^\circ\text{C}$ での値。注記がない限り、 $V_{CC1} = V_{CC2} = 5\text{V}$ 、 $V_{DD} = 0\text{V}_{DD} = 3\text{V}$ 。
 $V_{CC3} = 3\text{V}$ (LTM9004-AC、LTM9004-AD)、 $V_{CC3} = 5\text{V}$ (LTM9004-AA、LTM9004-AB)

SYMBOL	PARAMETER	CONDITIONS	MIN	TYP	MAX	UNITS
	Resolution (No Missing Codes)		14			Bits
	Integral Linearity Error (Note 4)	Differential Analog Input		± 1.5		LSB
	Differential Linearity Error	Differential Analog Input		± 1		LSB

デジタル入力とデジタル出力

●は全動作温度範囲の規格値を意味する。それ以外は $T_A = 25^\circ\text{C}$ での値。注記がない限り、 $V_{CC1} = V_{CC2} = 5\text{V}$ 、 $V_{DD} = 0\text{V}_{DD} = 3\text{V}$ 。
 $V_{CC3} = 3\text{V}$ (LTM9004-AC、LTM9004-AD)、 $V_{CC3} = 5\text{V}$ (LTM9004-AA、LTM9004-AB)

SYMBOL	PARAMETER	CONDITIONS	MIN	TYP	MAX	UNITS
--------	-----------	------------	-----	-----	-----	-------

ミキサのロジック入力 (MIXENABLE)

V_{IH}	High Level Input Voltage	$V_{CC1} = 5\text{V}$	●	2		V
V_{IL}	Low Level Input Voltage	$V_{CC1} = 5\text{V}$	●		1	V
I_{IN}	Input Current	$V_{IN} = V_{CC1}$		120		μA
	Turn On Time			120		ns
	Turn Off Time			750		ns

1番目のアンプのロジック入力 (AMP1ENABLE)

V _{IH}	High Level Input Voltage	V _{CC2} = 5V	●	2.55	2	V	
V _{IL}	Low Level Input Voltage	V _{CC2} = 5V	●		1.8	1.25	V
R _{IN}	Input Pull-Up Resistance	V _{CC2} = 5V, V _{AMP1ENABLE} = 0V to 0.5V		25		70	kΩ
	Turn On Time				200		ns
	Turn Off Time				50		ns

2番目のアンプのロジック入力 (AMP2ENABLE、LTM9004-AA、LTM9004-AB)

V _{IH}	High Level Input Voltage	V _{CC3} = 5V	●	V _{CC3} – 0.6	V
V _{IL}	Low Level Input Voltage	V _{CC3} = 5V	●	V _{CC3} – 2.1	V
R _{IN}	Input Pull-Up Resistance	V _{CC3} = 5V, V _{AMP2ENABLE} = 2.9V to 0V		40 66 90	kΩ
	Turn On Time			4	μs
	Turn Off Time			350	ns

2番目のアンプのロジック入力 (AMP2ENABLE、LTM9004-AC、LTM9004-AD)

V _{IH}	High Level Input Voltage	V _{CC3} = 3V	●	2.55	2.25	V
V _{IL}	Low Level Input Voltage	V _{CC3} = 3V	●		0.7 0.4	V
R _{IN}	Input Pull-Up Resistance	V _{CC3} = 3V, V _{AMP2ENABLE} = 0V to 0.5V		60	100 140	kΩ
	Turn On Time				200	ns
	Turn Off Time				50	ns

ADCのロジック入力 (CLK、 $\overline{\text{OE}}$ 、ADCSHDN、MODE、MUX)

V _{IH}	High Level Input Voltage	V _{DD} = 3V	●	2		V
V _{IL}	Low Level Input Voltage	V _{DD} = 3V	●	0.8		V
I _{IN}	Input Current	V _{IN} = 0V to V _{DD}	●	-10	10	μA
C _{IN}	Input Capacitance	(Note 6)		3		pF
I _{SENSE}	SENSE Input Leakage	0V < SENSE < 1V	●	-3	3	μA
I _{MODE}	MODE Input Leakage	0V < MODE < V _{DD}	●	-3	3	μA

9004fa

LTM9004

デジタル入力とデジタル出力

● は全動作温度範囲の規格値を意味する。それ以外は $T_A = 25^\circ\text{C}$ での値。注記がない限り、 $V_{CC1} = V_{CC2} = 5\text{V}$ 、 $V_{DD} = 0\text{V}$ 、 $V_{DD} = 3\text{V}$ 。
 $V_{CC3} = 3\text{V}$ (LTM9004-AC、LTM9004-AD)、 $V_{CC3} = 5\text{V}$ (LTM9004-AA、LTM9004-AB)

SYMBOL	PARAMETER	CONDITIONS	MIN	TYP	MAX	UNITS
ロジック出力						
$0\text{V}_{DD} = 3\text{V}$						
C_{OZ}	Hi-Z Output Capacitance	$\overline{OE} = 3\text{V}$ (Note 6)		3		pF
I_{SOURCE}	Output Source Current	$V_{OUT} = 0\text{V}$		50		mA
I_{SINK}	Output Sink Current	$V_{OUT} = 3\text{V}$		50		mA
V_{OH}	High Level Output Voltage	$I_O = -10\mu\text{A}$ $I_O = -200\mu\text{A}$	● 2.7	2.995 2.99		V V
V_{OL}	Low Level Output Voltage	$I_O = 10\mu\text{A}$ $I_O = 1.6\text{mA}$	●	0.005 0.09	0.4	V V
$0\text{V}_{DD} = 2.5\text{V}$						
V_{OH}	High Level Output Voltage	$I_O = -200\mu\text{A}$		2.49		V
V_{OL}	Low Level Output Voltage	$I_O = 1.6\text{mA}$		0.09		V
$0\text{V}_{DD} = 1.8\text{V}$						
V_{OH}	High Level Output Voltage	$I_O = -200\mu\text{A}$		1.79		V
V_{OL}	Low Level Output Voltage	$I_O = 1.6\text{mA}$		0.09		V

電源要件

● は全動作温度範囲の規格値を意味する。それ以外は $T_A = 25^\circ\text{C}$ での値。注記がない限り、 $V_{CC1} = V_{CC2} = 5\text{V}$ 、 $V_{DD} = 0\text{V}$ 、 $V_{DD} = 3\text{V}$ 。
 $V_{CC3} = 3\text{V}$ (LTM9004-AC、LTM9004-AD)、 $V_{CC3} = 5\text{V}$ (LTM9004-AA、LTM9004-AB) (Note 3)

SYMBOL	PARAMETER	CONDITIONS	MIN	TYP	MAX	UNITS
V_{CC1}	Mixer Supply Voltage		● 4.5		5.25	V
V_{CC2}	First Amplifier Supply Voltage		● 4.5		5.25	V
V_{CC3}	Second Amplifier Supply Voltage	LTM9004-AA, LTM9004-AB LTM9004-AC, LTM9004-AD	● 4.5 ● 2.7	3	5.25 3.5	V V
V_{DD}	ADC Analog Supply Voltage		● 2.7	3	3.6	V
0V_{DD}	ADC Digital Output Supply Voltage		● 0.5	3	3.6	V
I_{CC1}	Mixer Supply Current		●	129	180	mA
$I_{CC1}(\text{SHDN})$	Mixer Shutdown Current	MIXENABLE = 0V, AMPxENABLE = HIGH, ADCSHDN = 0V, $\overline{OE} = 0\text{V}$	●	10	11	mA
I_{CC2}	First Amplifier Supply Current		●	52	63	mA
$I_{CC2}(\text{SHDN})$	First Amplifier Shutdown Current	MIXENABLE = 5V, AMP1ENABLE = 0V, AMP2ENABLE = HIGH, ADCSHDN = 0V, $\overline{OE} = 0\text{V}$	●	7.5	9	mA
I_{CC3}	Second Amplifier Supply Current	LTM9004-AA, LTM9004-AB	●	21	24	mA
$I_{CC3}(\text{SHDN})$	Second Amplifier Shutdown Current	LTM9004-AA, LTM9004-AB, MIXENABLE = AMP1ENABLE = 5V, AMP2ENABLE = 0V, ADCSHDN = 0V, $\overline{OE} = 0\text{V}$	●	0.8	4	mA
I_{CC3}	Second Amplifier Supply Current	LTM9004-AC, LTM9004-AD	●	36	44	mA
$I_{CC3}(\text{SHDN})$	Second Amplifier Shutdown Current	LTM9004-AC, LTM9004-AD, MIXENABLE = AMP1ENABLE = 5V, AMP2ENABLE = 0V, ADCSHDN = 0V, $\overline{OE} = 0\text{V}$	●	0.6	4	mA
I_{DD}	ADC Supply Current		●	273	306	mA

9004fa

電源要件

● は全動作温度範囲の規格値を意味する。それ以外は $T_A = 25^\circ\text{C}$ での値。注記がない限り、 $V_{CC1} = V_{CC2} = 5\text{V}$ 、 $V_{DD} = 0$ 、 $V_{DD} = 3\text{V}$ 。
 $V_{CC3} = 3\text{V}$ (LTM9004-AC、LTM9004-AD)、 $V_{CC3} = 5\text{V}$ (LTM9004-AA、LTM9004-AB) (Note 3)

SYMBOL	PARAMETER	CONDITIONS	MIN	TYP	MAX	UNITS
$P_{D(\text{SLEEP})}$	Sleep Power	MIXENABLE = AMPxENABLE = 0V, ADCSHDN = 3V, $\overline{\text{OE}} = 3\text{V}$, No CLK		7		mW
$P_{D(\text{NAP})}$	Nap Mode Power	MIXENABLE = AMPxENABLE = 0V, ADCSHDN = 3V, $\overline{\text{OE}} = 0\text{V}$, No CLK		33		mW
$P_{D(\text{TOTAL})}$	Total Power Dissipation	LTM9004-AA, LTM9004-AB, MIXENABLE = AMP1ENABLE = AMP2ENABLE = 5V, ADCSHDN = 0V, $f_{\text{SAMPLE}} = \text{MAX}$		1.83		W
		LTM9004-AC, LTM9004-AD MIXENABLE = AMP1ENABLE = 5V, AMP2ENABLE = 3V, ADCSHDN = 0V, $f_{\text{SAMPLE}} = \text{MAX}$		1.83		W

タイミング特性

● は全動作温度範囲の規格値を意味する。それ以外は $T_A = 25^\circ\text{C}$ での値。注記がない限り、 $V_{CC1} = V_{CC2} = 5\text{V}$ 、 $V_{DD} = 0$ 、 $V_{DD} = 3\text{V}$ 。
 $V_{CC3} = 3\text{V}$ (LTM9004-AC、LTM9004-AD)、 $V_{CC3} = 5\text{V}$ (LTM9004-AA、LTM9004-AB)

SYMBOL	PARAMETER	CONDITIONS	MIN	TYP	MAX	UNITS
f_s	Sampling Frequency	●	1		125	MHz
t_L	CLK Low Time	Duty Cycle Stabilizer Off (Note 6)	3.8	4	500	ns
		Duty Cycle Stabilizer Off (Note 6)	3	4	500	ns
t_H	CLK High Time	Duty Cycle Stabilizer Off (Note 6)	3.8	4	500	ns
		Duty Cycle Stabilizer Off (Note 6)	3	4	500	ns
t_{JITTER}	Sample-and-Hold Acquisition Delay Time Jitter			0.2		psRMS
t_{AP}	Sample-and-Hold Aperture Delay			0		ns
t_D	CLK to DATA delay	$C_L = 5\text{pF}$ (Note 6)	1.4	2.7	5.4	ns
	DATA to CLKOUT Skew	$(t_D - t_C)$ (Note 6)	-0.6	0	0.6	ns
t_C	MUX to DATA Delay	$C_L = 5\text{pF}$ (Note 6)	1.4	2.7	5.4	ns
	DATA Access Time After $\overline{\text{OE}}\downarrow$	$C_L = 5\text{pF}$ (Note 6)		4.3	10	ns
	BUS Relinquish Time	(Note 6)		3.3	8.5	ns
	Pipeline Latency			5		Cycles

Note 1: 絶対最大定格に記載された値を超えるストレスはデバイスに永続的損傷を与える可能性がある。長期にわたって絶対最大定格条件に曝すと、デバイスの信頼性と寿命に悪影響を与える可能性がある。

Note 2: 全ての電圧値は(注記がない限り) GNDとOGNDを結線したグラウンドを基準にしている。

Note 3: 注記がない限り、 $f_{\text{SAMPLE}} = 125\text{MHz}$ 、 $\text{CLKI} = \text{CLKQ}$ 。

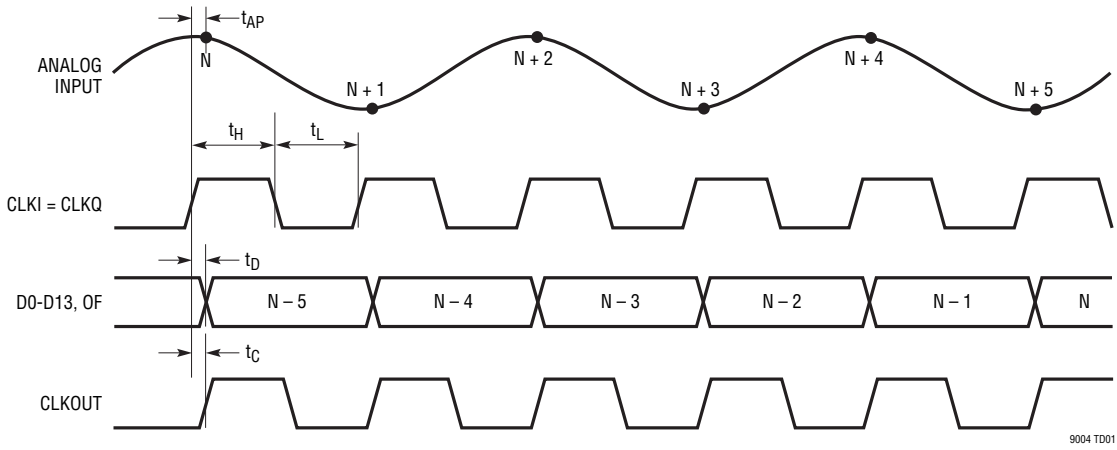
Note 4: 積分非直線性は、実際の伝達曲線のエンドポイントを通る直線からのコードの偏差として定義されている。偏差は量子化幅の中心から測定される。

Note 5: DCオフセット電圧は、LO信号が与えられているがRF信号は与えられていない状態での出力コードに対応したDC電圧として定義されている。

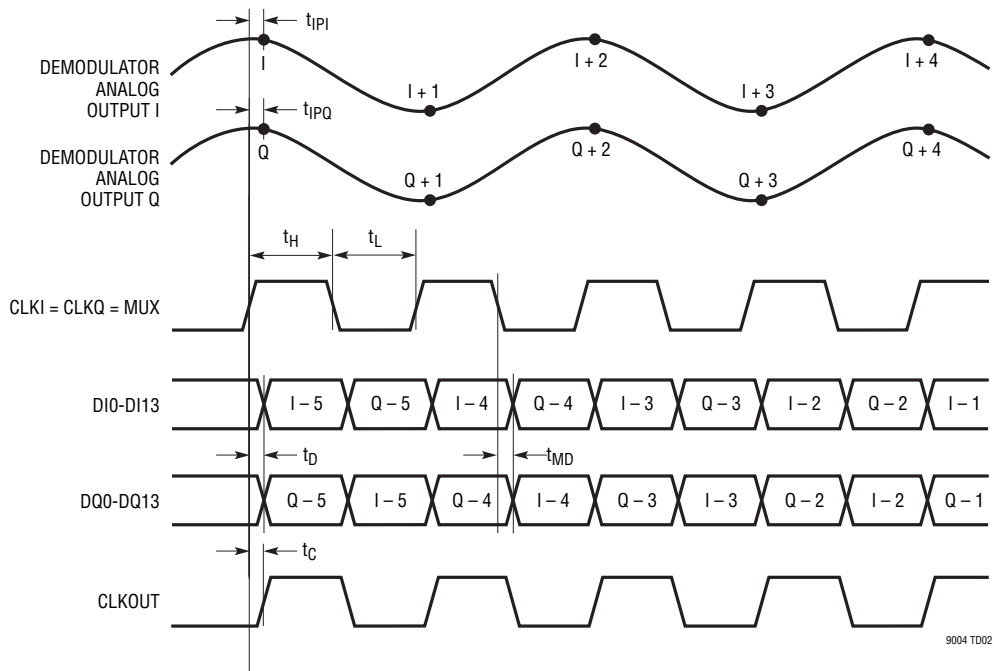
Note 6: 設計によって保証されているが、テストされない。

タイミング図

デュアル・デジタル出力バスのタイミング

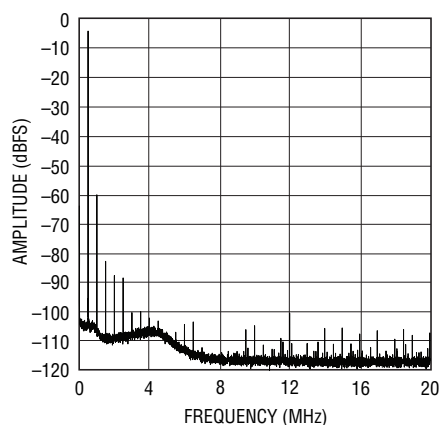


多重化されたデジタル出力バスのタイミング



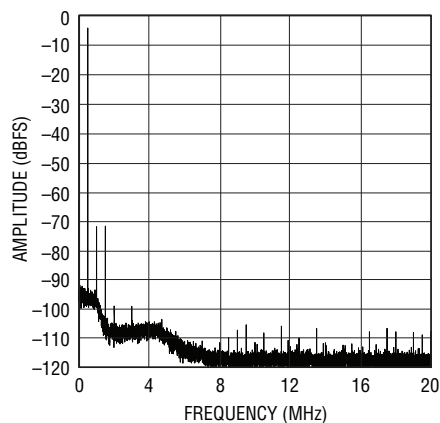
標準的性能特性

LTM9004-AA: 64kポイントのFFT

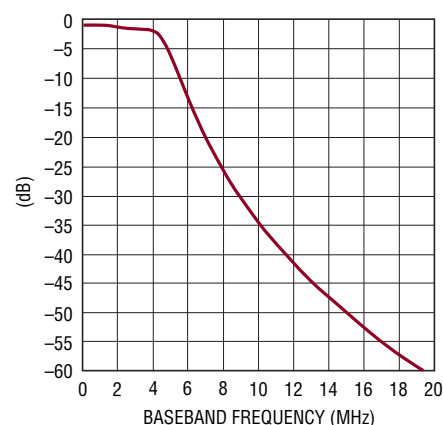
 $f_{IN} = 700.5\text{MHz}$, -1dBFSSENSE = V_{DD} 

9004 G01

LTM9004-AA: 64kポイントのFFT

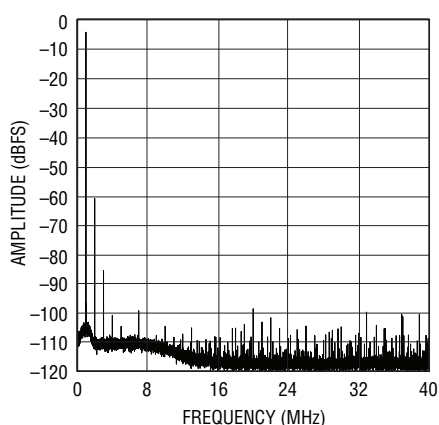
 $f_{IN} = 1950.5\text{MHz}$, -1dBFSSENSE = V_{DD} 

9004 G02

LTM9004-AA、
ベースバンド周波数応答

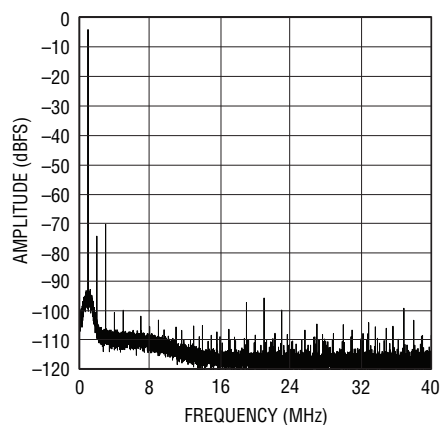
9004 G02a

LTM9004-AB: 64kポイントのFFT

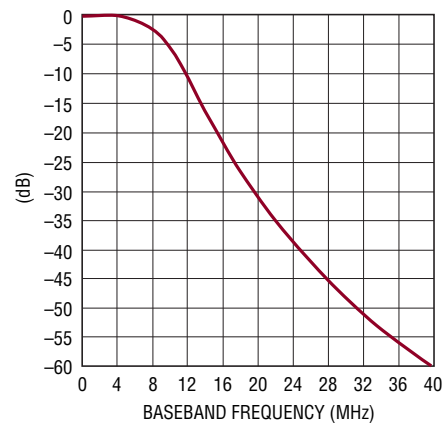
 $f_{IN} = 701.0\text{MHz}$, -1dBFSSENSE = V_{DD} 

9004 G03

LTM9004-AB: 64kポイントのFFT

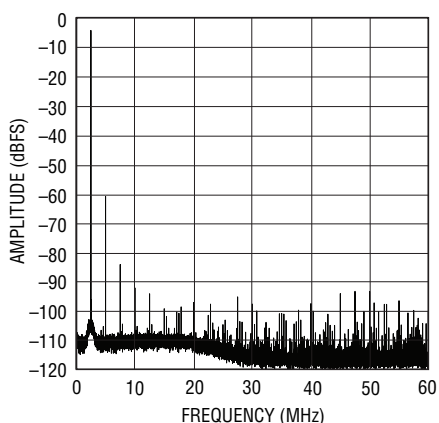
 $f_{IN} = 1951.0\text{MHz}$, -1dBFSSENSE = V_{DD} 

9004 G04

LTM9004-AB、
ベースバンド周波数応答

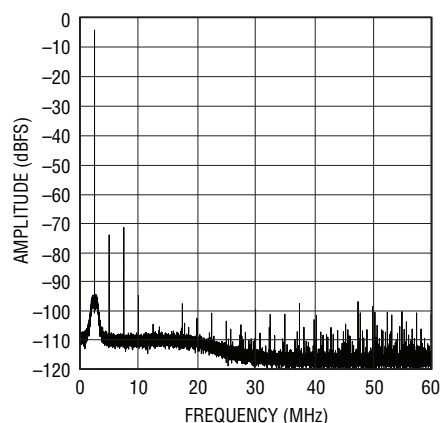
9004 G04a

LTM9004-AC: 64kポイントのFFT

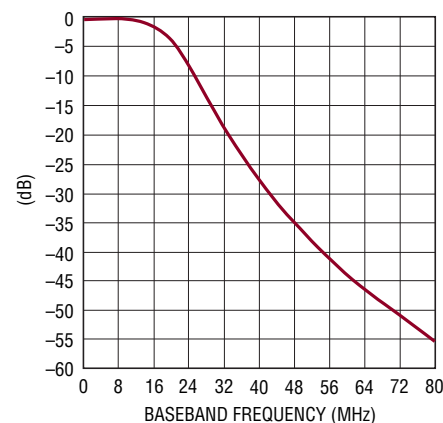
 $f_{IN} = 702.5\text{MHz}$, -1dBFSSENSE = V_{DD} 

9004 G05

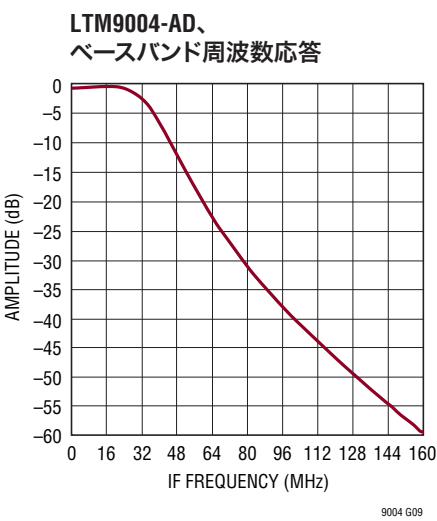
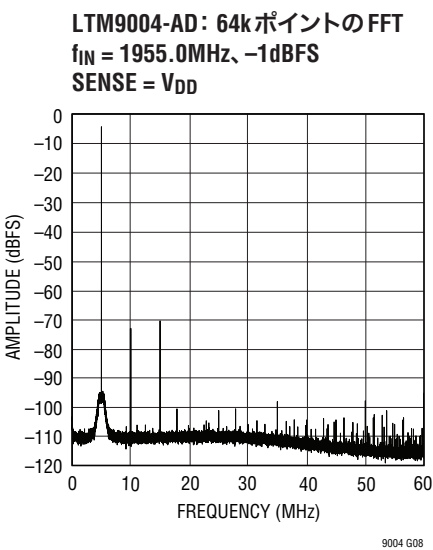
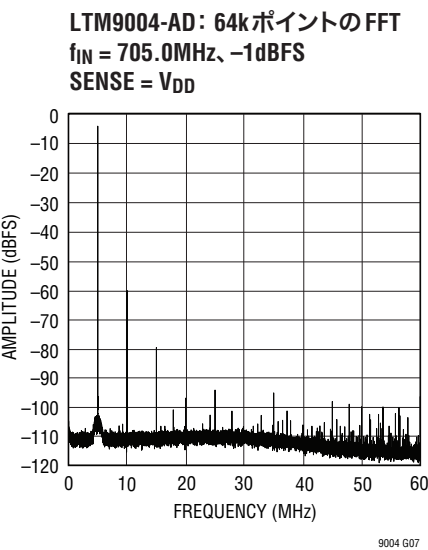
LTM9004-AC: 64kポイントのFFT

 $f_{IN} = 1952.5\text{MHz}$, -1dBFSSENSE = V_{DD} 

9004 G06

LTM9004-AC、
ベースバンド周波数応答9004 G06a
9004fa

標準的性能特性



ピン機能

電源ピン

V_{CC1} (ピン G5、H2)、V_{CC2} (ピン C5、C8、K5、K8) : ミキサおよび 1 番目のアンプのアナログ 5V 電源。規定動作範囲は 4.5V ~ 5.25V です。このピンの電圧はミキサおよびアンプ段にだけ電力を供給し、内部で GND にバイパスされています。

V_{CC3} (ピン C9、C12、K9、K12) : 2 番目のアンプのアナログ電源。LTM9004-AA と LTM9004-AB の場合、規定動作範囲は 4.5V ~ 5.5V です。LTM9004-AC と LTM9004-AD の場合、規定動作範囲は 2.7V ~ 3.5V です。V_{CC3} は内部で GND にバイパスされています。

V_{DD} (ピン D14、F13、G13、J14) : ADC 用アナログ 3V 電源。規定動作範囲は 2.7V ~ 3.6V です。V_{DD} は内部で GND にバイパスされています。

OV_{DD} (ピン D17、J17) : デジタル出力ドライバの正電源。規定動作範囲は 0.5V ~ 3.6V です。OV_{DD} は内部で OGND にバイパスされています。

GND (ピン配置については表を参照) : アナログ・グラウンド。

OGND (ピン C17、K17) : デジタル出力ドライバのグラウンド。

アナログ入力

RF (ピン E2) : RF 入力ピン。これは 50Ω で終端されたシングルエンド入力です。高周波数帯域のための外部整合ネットワークは不要です。700MHz ~ 1.5GHz の低周波数帯域では 50Ω へのインピーダンス変換のために、外部直列コンデンサ (およびシャント・コンデンサ) が必要になることがあります (図 4 を参照)。RF ソースが DC ブロックされていない場合、直列にブロッキング・コンデンサを使います。そうでないと、デバイスが損傷を受けるおそれがあります。

LO (ピン H3) : ローカル発振器の入力ピン。これは 50Ω で終端されたシングルエンド入力です。高周波数帯域では外部整合ネットワークは不要です。700MHz ~ 1.5GHz の低周波数帯域では 50Ω へのインピーダンス変換のために、外部シャント・コンデンサ (または直列コンデンサ) が必要になることがあります (図 6 を参照)。LO ソースが DC ブロックされていない場合、直列にブロッキング・コンデンサを使う必要があります。そうでないと、デバイスが損傷を受けるおそれがあります。

CLKQ (ピン G14) : Q チャネル ADC のクロック入力。立ち上がりエッジで入力のサンプリングが開始されます。CLKQ と CLKI を一緒に接続します。

CLKI (ピン F14) : I チャネルの ADC のクロック入力。立ち上がりエッジで入力のサンプリングが開始されます。CLKQ と CLKI を一緒に接続します。

I⁺_ADJ (ピン B1) : I チャネルの、+ラインの DC オフセット調整ピン。このピンを通して電流をソースまたはシンクして DC オフセットを調整します。

I⁻_ADJ (ピン C1) : I チャネルの、-ラインの DC オフセット調整ピン。このピンを通して電流をソースまたはシンクして DC オフセットを調整します。

Q⁺_ADJ (ピン K1) : Q チャネルの、+ラインの DC オフセット調整ピン。このピンを通して電流をソースまたはシンクして DC オフセットを調整します。

Q⁻_ADJ (ピン L1) : aQ チャネルの、-ラインの DC オフセット調整ピン。このピンを通して電流をソースまたはシンクして DC オフセットを調整します。

制御ピン

MIXENABLE (ピン E4) : ミキサ・イネーブル・ピン。MIXENABLE = “H” (入力電圧が 2.0V より上) であれば、ミキサはイネーブルされます。MIXENABLE = “L” (入力電圧が 1.0V より下) であれば、ディスエーブルされます。イネーブル機能が不要なら、このピンを V_{CC1} に接続します。

AMP1ENABLE (ピン D5、L5) : 1 番目のアンプのイネーブル・ピン。AMP1ENABLE = “H” またはフロートであれば、各チャネルの 1 番目のアンプは通常 (アクティブ) 動作モードになります。AMP1ENABLE = “L” (V_{CC2} より最小 2.1V 下) であれば、1 番目のアンプはディスエーブルされます。イネーブル機能が不要なら、このピンを V_{CC2} に接続します。

AMP2ENABLE (ピン C10、L10) : 2 番目のアンプのイネーブル・ピン。AMP2ENABLE = “H” またはフロートであれば、各チャネルの 2 番目のアンプは通常 (アクティブ) 動作モードになります。AMP2ENABLE = “L” (V_{CC3} より最小 0.45V 下) であれば、2 番目のアンプはディスエーブルされます。イネーブル機能が不要なら、このピンを V_{CC3} に接続します。

ADCSHDNQ (ピン J12) : Q チャネルの ADC のシャットダウン・モードの選択ピン。ADCSHDNQ と $\overline{\text{OEQ}}$ を GND に接続すると通常動作になり、出力がイネーブルされます。ADCSHDNQ を GND に接続し、 $\overline{\text{OEQ}}$ を V_{DD} に接続すると通常動作になり、出力が高インピーダンスになります。ADCSHDNQ を V_{DD} に接続し、 $\overline{\text{OEQ}}$ を GND に接続するとナップ・モードになり、出力が高インピーダンスになります。ADCSHDNQ と $\overline{\text{OEQ}}$ を V_{DD} に接続するとスリープ・モードになり、出力が高インピーダンスになります。

ADCSHDNI (ピン D12) : I チャネルの ADC のシャットダウン・モードの選択ピン。ADCSHDNI と $\overline{\text{OEI}}$ を GND に接続すると

ピン機能

通常動作になり、出力がイネーブルされます。ADCSHDNIをGNDに接続し、 \overline{OEI} を V_{DD} に接続すると通常動作になり、出力が高インピーダンスになります。ADCSHDNIを V_{DD} に接続し、 \overline{OEI} をGNDに接続するとナップ・モードになり、出力が高インピーダンスになります。ADCSHDNIと \overline{OEI} を V_{DD} に接続するとスリープ・モードになり、出力が高インピーダンスになります。

SENSEQ (ピン H13)、SENSEI (ピン E13) : ADCのリファレンスのプログラミング・ピン。通常動作させるには V_{DD} に接続します。外部リファレンスを使うことができます(「ADCのリファレンス」のセクションを参照)。

MODE (ピン J13) : 出力のフォーマットとクロック・デューティ・サイクル・スタビライザの選択ピン。MODEは両方のチャンネルをコントロールすることに注意してください。MODEをGNDに接続すると、ストレート・バイナリの出力フォーマットが選択され、クロック・デューティ・サイクル・スタビライザがオフします。1/3 V_{DD} に接続すると、ストレート・バイナリの出力フォーマットが選択され、クロック・デューティ・サイクル・スタビライザがオンします。2/3 V_{DD} に接続すると、2の補数の出力フォーマットが選択され、クロック・デューティ・サイクル・スタビライザがオンします。 V_{DD} に接続すると、2の補数の出力フォーマットが選択され、クロック・デューティ・サイクル・スタビライザがオフします。

MUX (ピン D13) : デジタル出力のマルチプレクサ・コントロール。MUX = “H”だと、QチャンネルはDQ0～DQ13から出力し、

IチャンネルはDI0～DI13から出力します。MUX = “L”だと出力バスが入れ替わり、QチャンネルはDI0～DI13から出力し、IチャンネルはDQ0～DQ13から出力します。両方のチャンネルを1本の出力バスに多重化するにはMUX、CLKQおよびCLKIを一緒に結合します。

\overline{OEQ} (ピン K13) : Qチャンネルの出力イネーブル・ピン。ADCSHDNQピンの機能を参照してください。

\overline{OEI} (ピン C13) : Iチャンネルの出力イネーブル・ピン。ADCSHDNIピンの機能を参照してください。

デジタル出力

CLKOUT (ピン E12) : ADCのデータ・レディ・クロック出力。CLKOUTの立ち下がりエッジでデータをラッチします。CLKOUTはCLKQから得られます。同時動作ではCLKQをCLKIに接続します。

DI0～DI13 (ピン配置については表を参照) : Iチャンネル(同相)のADCのデジタル出力。DI13がMSBです。

DQ0～DQ13 (ピン配置については表を参照) : Qチャンネル(直交)のADCのデジタル出力。DQ13がMSBです。

OF (ピン H12) : オーバーフロー/アンダーフロー出力。IチャンネルまたはQチャンネルにオーバーフローまたはアンダーフローが生じると“H”になります。

ピン配置

	A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	L	M
1	◇ND	☆+_ADJ	☆-_ADJ	◇ND	◇ND	◇ND	◇ND	◇ND	◇ND	☆+_ADJ	☆-_ADJ	◇ND
2	◇ND	◇ND	◇ND	◇ND	☆F	◇ND	◇ND	☆CC1	◇ND	◇ND	◇ND	◇ND
3	◇ND	◇ND	◇ND	◇ND	◇ND	◇ND	◇ND	☆O	◇ND	◇ND	◇ND	◇ND
4	◇ND	◇ND	◇ND	◇ND	☆IX_EN	◇ND	◇ND	◇ND	◇ND	◇ND	◇ND	◇ND
5	◇ND	◇ND	☆CC2	☆MP1A_EN	◇ND	◇ND	☆CC1	◇ND	◇ND	☆CC2	☆MP1B_EN	◇ND
6	◇ND	◇ND	◇ND	◇ND	◇ND	◇ND	◇ND	◇ND	◇ND	◇ND	◇ND	◇ND
7	◇ND	◇ND	◇ND	◇ND	◇ND	◇ND	◇ND	◇ND	◇ND	◇ND	◇ND	◇ND
8	◇ND	◇ND	☆CC2	◇ND	◇ND	◇ND	◇ND	◇ND	◇ND	☆CC2	◇ND	◇ND
9	◇ND	◇ND	☆CC3	◇ND	◇ND	◇ND	◇ND	◇ND	◇ND	☆CC3	◇ND	◇ND
10	◇ND	◇ND	☆MP2A_EN	◇ND	◇ND	◇ND	◇ND	◇ND	◇ND	◇ND	☆MP2B_EN	◇ND
11	◇ND	◇ND	◇ND	◇ND	◇ND	◇ND	◇ND	◇ND	◇ND	◇ND	◇ND	◇ND
12	◇ND	◇ND	☆CC3	☆HDNI	☆LKOUT	◇ND	◇ND	☆F	☆HDNQ	☆CC3	◇ND	◇ND
13	♣I3	♣I0	\overline{OEI}	☆UX	☆ENSEI	☆DD	☆DD	☆ENSEQ	☆ODE	\overline{OEQ}	♣Q13	♣Q10
14	♣I8	♣I4	♣I1	☆DD	◇ND	♣LKI	♣LKQ	◇ND	☆DD	♣Q12	♣Q8	♣Q6
15	♣I7	♣I6	♣I2	◇ND	◇ND	◇ND	◇ND	◇ND	◇ND	♣Q11	♣Q4	♣Q5
16	◇ND	♣I9	♣I5	♣I10	♣I11	◇ND	◇ND	♣Q1	♣Q3	♣Q9	♣Q7	◇ND
17	◇ND	◇ND	☆GND	☆VDD	♣I12	♣I13	♣Q0	♣Q2	☆VDD	☆GND	◇ND	◇ND

□品を透かして見たLGAパッケージの上面図

ブロック図

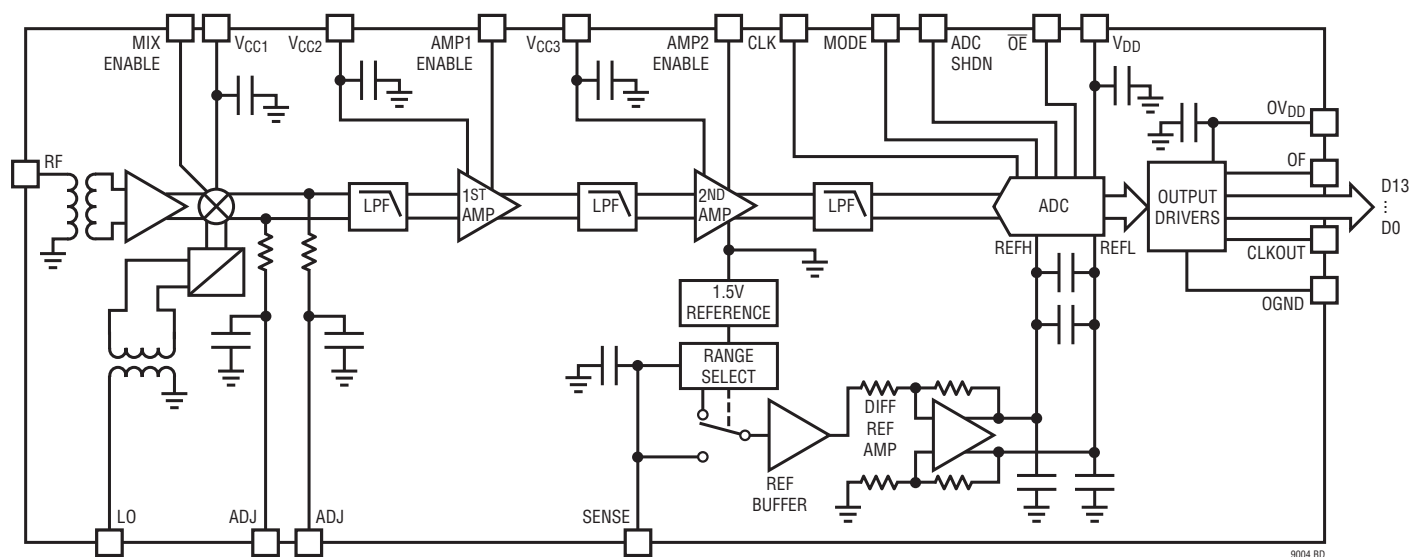


図1. 機能ブロック図(1チャンネルだけ示されている)

動作

概要

LTM9004は、RF入力周波数が2.7GHzまでのワイヤレス・インフラストラクチャなど、高直線性レシーバのアプリケーション向けのダイレクトコンバージョン・レシーバです。これは、SiP (system in a package) テクノロジーを利用して一体化された μ Module レシーバで、デュアルの高速14ビットA/Dコンバータ、ローパス・フィルタ、チャンネル当たり2個の固定利得低ノイズ差動アンプ、およびDCオフセット調整機能付きI/Q復調器を組み合わせています。

ダイレクトコンバージョン・レシーバ・アーキテクチャは従来のスーパーヘテロダインに比べていくつかの長所を備えています。それは、イメージ周波数の信号の影響を受けにくいので、RFフロントエンドのバンドパス・フィルタの要件を緩和します。RFバンドパス・フィルタに要求されるのは、強い帯域外信号を減衰させてそれらがフロントエンドに負担を掛けすぎないように防ぐことです。また、直接変換はIFアンプとバンドパス・フィルタも不要にします。代わりに、RF入力信号はベースバンドに直接変換されます。

ただし、直接変換はそれ固有の実装に関する問題を伴います。受信LO信号はRF信号と同じ周波数ですから、受信アンテナから簡単に放射され、法規上の規定に違反することがあります。

レシーバの2次非直線性によって不要のベースバンド信号が生じることもあります。レシーバに入ってくる任意の周波数のトーンは、ベースバンド回路にDCオフセットを生じます。また、レシーバの2次非線形性は、変調信号が(望みの信号であっても)DCの周囲に疑似ランダム・ブロックのエネルギーを発生することを許します。

このため、LTM9004は、I/Q復調後の直後にDCオフセット補正を行います。一旦発生した後、DCオフセットを単純に除去すると厄介な問題が生じます。ベースバンド・アンプの周波数応答はDCまで延びているので、ベースバンド・アンプの必要な利得によりオフセットが増加します。

以下のセクションでは各部分の動作を詳細に説明します。 μ Module テクノロジーによりLTM9004はカスタム化が可能で、それについては最初のセクションで説明します。残りのセクションのアウトラインは図2に示されている基本的機能要素に従います。

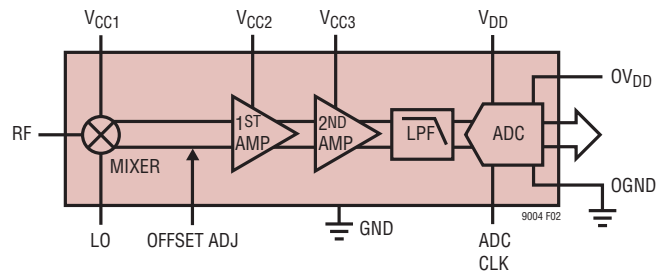


図2. 基本的機能要素 (半分だけ示してある)

セミカスタム・オプション

μ Module 構造は、アプリケーション固有の標準製品に新しいレベルの柔軟性を与えます。特定のアプリケーション向けに、標準的ADC、アンプおよびRFの各構成要素を(それらのプロセス・テクノロジーに関係なく)統合し、受動部品に適合させることができます。最初の例として、LTM9004-AAは最高125Mspsのレートでサンプリングするデュアル14ビットADCを使って構成されています。アンプは(ミキサの利得を含め)14dBの全電圧利得を与えます。ローパス・フィルタは帯域幅を1.92MHzに制限します。I/Q復調器のRF入力とLO入力には内蔵トランスが備わっており、50 Ω のシングルエンド入力を与えます。DCオフセットのキャンセルに外部DACを使うことができます。

ただし、リニアテクノロジーのセミカスタム開発プログラムにより他のオプションも可能です。リニアテクノロジーは、ほとんどどんなアプリケーションにも対応する、他のサンプル・レート、分解能、利得およびフィルタ構成を提供するプログラムを用意しています。これらのセミカスタム・デザインは、適切に変更を加えた受動ネットワークと組み合わせた既存の部品をベースにします。次いで、アプリケーションで定義された正確なパラメータに対して最終サブシステムがテストされます。最終的には、同じパッケージに完全に一体化され、正確にテストされ、最適化されたソリューションになります。セミカスタムのレシーバ・サブシステム・プログラムの詳細については、弊社にお問い合わせください。

ミキサの動作

RF信号はRFトランスコンダクタンス・アンプの入力に与えられ、次に直交LO信号を使ってI/Qベースバンド信号に復調されます。この直交LO信号は高精度90°位相シフトにより外部LOソースから内部で作られます。

動作

RFとLOの両方の入力に広帯域内蔵トランスが備わっており、シングルエンドのRFとLOのインタフェースが可能です。広い周波数帯域で(1.5GHz～2.7GHz)、RFポートとLOポートの両方が内部で50Ωに整合しています。外付けの整合部品は不要です。低い周波数帯域(700MHz～1.5GHz)では、直列コンデンサまたはシャント・コンデンサの簡単なネットワークをインピーダンス整合ネットワークとして使うことができます。

IチャネルとQチャネルの位相関係

IチャネルとQチャネルの出力信号間の位相関係は固定されています。LO入力周波数がRF入力周波数より大きい(または小さい)とき、Qチャネルの出力(DQ0～DQ13)はIチャネルの出力(DI0～DI13)より90°だけ位相が遅れ(または進み)ます。

DCオフセットの調整

各チャネルにはA/Dコンバータの入力に与えられるDCオフセット電圧の調整機能が備わっています。各チャネルには2つの調整端子があるので、同相モードと差動モードのDCオフセットを個別にトリミングすることができます。これらの端子は最大0.3mAのソース電流またはシンク電流を受け入れるように設計されています。2つの端子を流れる電流が等しくないと、差動DCオフセットが生じます。それらが等しいと、DCオフセットは同相のみとなります。一例として、一方の端子から0.1mAをシンクし、他方の端子から0.11mAをシンクすると、差動オフセットは約5.9mV (48LSB)になります。調整端子に5Vの差動電圧を加えることにより、最大約178mV (1457LSB)のDCオフセットを強制することができます。

アンプの動作

LTM9004の各チャネルは、2段の、DC結合された、低ノイズで低歪みの完全に差動のオペアンプ/ADCドライバで構成されています。各段は、高速の高性能オペアンプと高精度受動部品を使った2ポールのアクティブ・ローパス・フィルタを実装しています。この2段のカスケード構成は、最大利得と位相平坦度を与え、隣接チャネルとブロッカを除去するように設計されています。アンプの範囲内で、異なるカットオフ周波数のローパス応答を設定することができます。たとえば、LTM9004-AAのローパスフィルタは1.92MHzに設定されています。

ADCの入力ネットワーク

2番目のアンプの出力段とADCの入力段の間の受動ネットワークは、ローパス応答の1次トポロジーを構成しています。

コンバータの動作

図1に示されているA/Dコンバータ(ADC)は、デュアルのCMOSパイプライン・マルチステップ・コンバータです。パイプライン構成の6つのADC段を備えており、サンプリングされたアナログ入力は6サイクル後にデジタル値になります(タイミング図を参照)。CLK入力はシングルエンドです。ADCはCLK入力ピンの状態で定まる2つのフェーズで動作します。

パイプライン構成の各段は、1個のADC、再構成DAC、および段間残余アンプを備えています。動作時、ADCは各段の入力を量子化し、量子化された値はDACによって入力から差し引かれ、残余を生じます。残余は残余アンプによって増幅されて出力されます。奇数段がその残余を出力しているとき偶数段がその残余を取得するように、またその逆になるように、後に続く段は位相がずれて動作します。

CLKが“L”のとき、アナログ入力が入力のサンプル&ホールド・コンデンサに差動で直接サンプルされます。CLKが“L”から“H”に遷移する瞬間、サンプリングされた入力がホールドされます。CLKが“H”の間、ホールドされた入力電圧はS/Hアンプによってバッファされます。このS/Hアンプはパイプライン構成の最初のADC段をドライブします。初段はCLKのこの“H”フェーズの間にS/Hの出力を取得します。CLKが“L”に戻ると初段はその残余を出力し、この残余が2番目の段によって取得されます。同時に、入力のS/Hは再度アナログ入力を取得します。CLKが“H”に戻ると2番目の段はその残余を出力し、この残余が3番目の段によって取得されます。同様の過程が3番目、4番目、さらに5番目の段で繰り返され、5番目の段の残余は最終評価のために6番目の段のADCに送られます。

初段に続く各ADC段にはフラッシュ誤差とアンプのオフセット誤差を調節するための追加範囲があります。ADCの全段からの結果は、出力バッファに送る前に、それらの結果を補正ロジックで適切に結合できるようにデジタル動作で同期させます。

アプリケーション情報

RF入力

内蔵トランスと高直線性トランスコンダクタンス・アンプによって構成されている、ミキサのRF入力を図3に示します。トランスの1次側はRF入力ピンに接続されています。トランスの2次側はトランスコンダクタンス・アンプの差動入力に接続されています。いかなる場合にも、RF入力ピンにDC電圧を印加してはいけません。トランスの1次側に流れ込むDC電流は内蔵トランスに損傷を与える可能性があります。直列ブロッキング・コンデンサを使ってRF入力ポートをRF信号源にAC結合します。

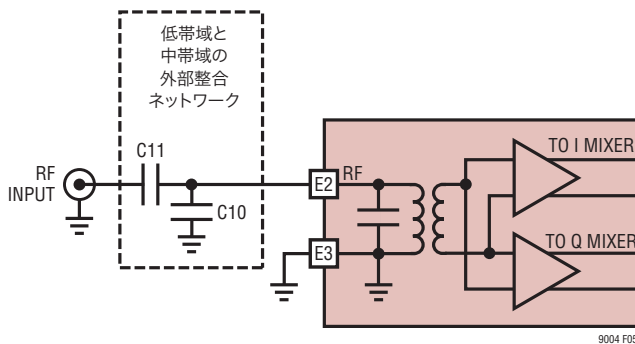


図3. RF入力のインタフェース

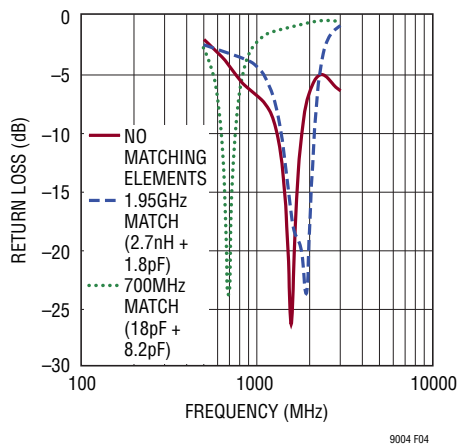


図4. RFポートのリターン損失と周波数

RF入力ポートは1.5GHz～2.7GHzの広い周波数範囲にわたって内部で整合しており、入力リターン損失は標準で10dBより優れています。この周波数範囲では外部整合ネットワークは不要です。ただし、デバイスが低い周波数で動作するとき

は、図3に示されている整合ネットワークにより、入力リターン損失が改善されます。図4に示されているように、所期の周波数で入力の最適インピーダンス整合を得るために、シャント・コンデンサC10と直列コンデンサC11を選択することができます。低い周波数帯域の動作では、外部整合部品C11が直列DCブロッキング・コンデンサとして機能することができます。

RF入力インピーダンスとS11パラメータを表1に示します(外部整合部品なし)。

表1. RF入力インピーダンス

周波数(MHz)	大きさ	位相(°)	R(Ω)	X(Ω)
500	0.78	-139.7	16.1	-10.7
600	0.69	-166.6	10.1	-3.8
700	0.60	163.7	14.0	3.8
800	0.52	132.6	25.8	6.9
900	0.48	102.7	41.9	3.4
1000	0.45	77.4	58.8	-4.3
1100	0.42	56.6	74.9	-11.4
1200	0.38	40.1	86.4	-12.4
1300	0.31	25.7	87.6	-7.1
1400	0.22	10.9	76.8	-1.4
1500	0.10	-14.5	60.9	0.3
1600	0.06	-132.9	45.9	-0.2
1700	0.19	-170.7	34.6	-0.4
1800	0.30	-177.7	26.8	0.2
1900	0.40	-172.1	21.8	1.1
2000	0.47	-169.4	18.7	1.9
2100	0.51	-168.6	16.7	2.2
2200	0.54	-169.3	15.4	2.3
2300	0.55	-172.0	14.7	1.7
2400	0.55	-176.0	14.4	0.9
2500	0.54	-178.7	14.9	-0.3
2600	0.52	-172.3	15.9	-1.6
2700	0.50	-164.3	17.6	-3.0
2800	0.49	-155.0	19.9	-4.3
2900	0.48	-144.7	22.9	-5.4
3000	0.48	-134.8	26.4	-6.0

LO入力ポート

ミキサのLO入力インタフェースを図5に示します。入力には内蔵トランスと高精度直行位相シフタによって構成されており、I/QミキサをドライブするLOバッファ・アンプのために位相のシフ

アプリケーション情報

トした0°と90°のLO信号を発生します。トランスの1次側はLO入力ピンに接続されています。トランスの2次側はLO直交ジェネレータの差動入力に接続されています。どんな場合にも、この入力ピンにDC電圧を印加してはいけません。トランスの1次側に流れ込むDC電流はトランスに損傷を与える可能性があります。直列ブロッキング・コンデンサを使ってLO入力ポートをLO信号源にAC結合します。

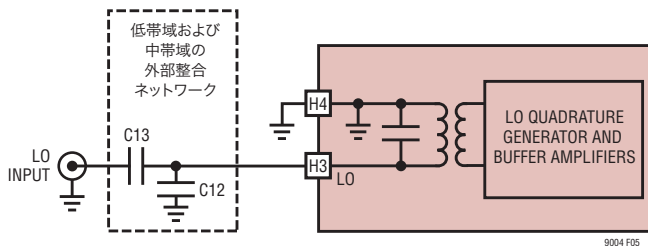


図5. LO入力インタフェース

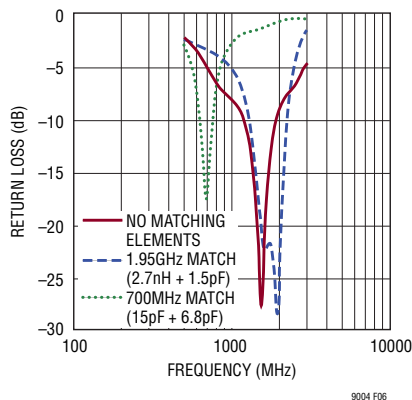


図6. LOのリターン損失と周波数

LO入力ポートは1.5GHz～2.7GHzの広い周波数範囲にわたって内部で整合しており、入力リターン損失は標準で10dBより優れています。この周波数範囲では外部整合ネットワークは不要です。デバイスが低い周波数で動作するときは、図8に示されている整合ネットワークにより、入力リターン損失が改善されます。図6に示されているように、望みの周波数で入力の最適インピーダンス整合を得るために、シャント・コンデンサC12と直列コンデンサC13を選択することができます。低周波数動作では、外部整合部品C13が直列DCブロッキング・コンデンサとして機能することができます。

LO入力インピーダンスとS11パラメータを表2に示します(外部整合部品なし)。

表2. LO入力インピーダンス

周波数(MHz)	大きさ	位相 (°)	R (Ω)	X (Ω)
500	0.77	-143.2	14.8	-10.0
600	0.66	-172.6	10.6	-2.0
700	0.55	154.5	17.8	5.1
800	0.46	119.8	33.1	5.5
900	0.41	88.8	50.8	-0.3
1000	0.39	63.9	67.5	-7.4
1100	0.35	44.9	80.2	-10.1
1200	0.30	31.5	83.4	-7.2
1300	0.23	22.7	76.9	-3.1
1400	0.14	20.7	65.2	-0.9
1500	0.05	47.3	53.6	-0.1
1600	0.08	139.3	44.1	0.3
1700	0.17	152.3	36.9	0.9
1800	0.25	154.7	31.7	1.6
1900	0.31	157.5	27.9	2.0
2000	0.35	160.5	25.1	2.2
2100	0.38	164.9	23.1	2.0
2200	0.41	170.3	21.4	1.4
2300	0.42	177.7	20.2	0.4
2400	0.44	-173.8	19.6	-1.0
2500	0.46	-164.6	19.7	-2.6
2600	0.48	-155.7	20.2	-4.1
2700	0.51	-147.1	21.2	-5.6
2800	0.54	-139.2	22.8	-6.8
2900	0.56	-131.5	25.2	-7.6
3000	0.58	-124.9	27.9	-7.9

ADCのリファレンス

内部電圧リファレンスは、ピンで選択可能なADCの2つの入力範囲に構成設定することができます。SENSEピンをV_{DD}に接続すると既定の範囲が選択され、SENSEピンを1.5Vに接続すると3dB低い範囲が選択されます。外部リファレンスを使って、その出力を直接または抵抗分割器を通してSENSEに与えることができます。ロジック・デバイスを使ってSENSEピンをドライブすることは推奨しません。SENSEピンはできるだけコンバータの近くで適切なレベルに接続します。SENSEピンは、1μFセラミック・コンデンサを使って内部でグランドにバイパスしてあります。

アプリケーション情報

イネーブル・インタフェース

ミキサをオンするのに必要なイネーブル電圧は2Vです。ミキサをディスエーブルまたはオフするには、この電圧を1Vより下にします。このピンが接続されていないと、ミキサはディスエーブルされます。ただし、通常動作でこのピンをフロート状態にしておくことは推奨しません。

AMP1ENABLEピンとAMP2ENABLEピンはCMOS ロジック入力で、内部プルアップ抵抗を備えています。ピンを“L”にドライブすると、アンプがパワーダウンし、出力がHi-Zになります。ピンを未接続のままにするか、“H”にドライブすると、デバイスは通常の動作状態になります。偶発的なシャットダウンを防ぐために、このピンのリーク電流を制御するよう注意が必要です。シャットダウン状態とアクティブ状態の間のターンオン時間およびターンオフ時間は標準で1 μ s未満です。

スリープ・モードとナップ・モード

節電のため、コンバータをシャットダウン・モードまたはナップ・モードにすることができます。ADCSHDNxをGNDに接続すると通常動作になります。ADCSHDNxをV_{DD}に接続し、 $\overline{\text{OE}}_x$ をV_{DD}に接続するとスリープ・モードになり、リファレンスを含む全ての回路がパワーダウンし、ADCの電力損失は標準で1mWになります。スリープ・モードを抜け出すとき、リファレンスのコンデンサを再充電して安定化する必要がありますので、出力データが有効になるまで数ミリ秒かかります。ADCSHDNxをV_{DD}に接続し、 $\overline{\text{OE}}_x$ をGNDに接続するとナップ・モードになり、ADCの電力損失は標準で30mWになります。ナップ・モードでは内蔵リファレンス回路はオンしたままなので、ナップ・モードからの回復はスリープ・モードからの回復よりも速く、標準で100クロック・サイクルかかります。スリープとナップの両方のモードで全てのデジタル出力はディスエーブルされ、Hi-Z状態になります。

チャンネルIとチャンネルQには独立したADCSHDNピン (ADCSHDNI、ADCSHDNQ) が備わっています。IチャンネルはADCSHDNIと $\overline{\text{OE}}_I$ によって制御され、QチャンネルはADCSHDNQと $\overline{\text{OE}}_Q$ によって制御されます。2本のチャンネルのナップ・モード、スリープ・モードおよび出力イネーブル・モードは完全に独立しているので、一方のチャンネルを動作させながら、他方のチャンネルをナップ・モードまたはスリープ・モードにすることができます。

ADCSHDNの極性は、MIXENABLE、AMP1ENABLEおよびAMP2ENABLEとは逆であることに注意してください。通常

動作はSHDNピンのロジック“L”レベルによって行われ、“H”レベルによってそれぞれの機能がディスエーブルされます。

個別のコンポーネントを別々にイネーブルまたはシャットダウンすることは推奨しません。これらのピンはテストのために分離されています。

ADCのクロック入力のドライブ

CLK入力はCMOSまたはTTLレベルの信号で直接ドライブすることができます。CLKピンの前にジッタの小さな方形波発生回路を置いて正弦波のクロックを使うこともできます (図7)。

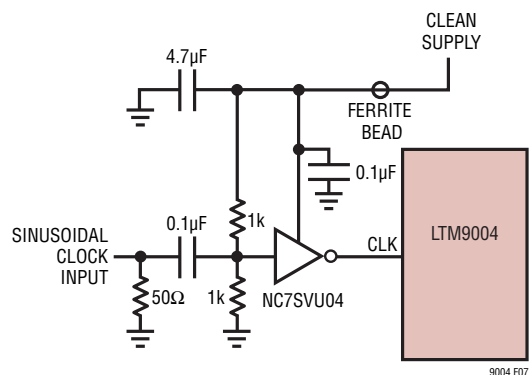


図7. 正弦波シングルエンド CLKドライバ

ADCのノイズ特性はアナログ入力に依存するのと同程度にクロック信号の品質に依存することがあります。CLK信号に含まれるどんなノイズも新たなアパーチャ・ジッタを生じ、このジッタは本来のADCアパーチャ・ジッタにRMSとして追加されます。高い入力周波数をデジタル変換する場合など、ジッタに対する要求が厳しいアプリケーションではできるだけ大きな振幅を使います。また、正弦波信号でADCをクロック駆動する場合、クロック信号にフィルタをかけて広帯域ノイズとソースによって生じた歪み積を減らします。

CLKIとCLKQを短絡して同じクロック・ソースでドライブすることを推奨します。2つのチャンネルがアナログ入力をサンプリングするタイミングの間に小さな遅延時間を置くのが望ましい場合、CLKIとCLKQを2つの異なった信号でドライブすることができます。この遅延時間が1nsを超えると、デバイスの性能が低下することがあります。CLKIとCLKQは非同期信号でドライブしないでください。

アプリケーション情報

差動クロックをシングルエンドCLK入力に変換する別の方法を図8と図9に示します。トランスを使うと位相ノイズの増加はありません。LVDSまたはPECLからCMOSへの変換器は70MHz以下ではSNRがほとんど劣化しませんが、140MHzではトランスのソリューションに比べてSNRが劣化します。受信した信号の性質もSNRがどれだけ劣化するかに大きく関係します。WCDMAやOFDMなどの波高率の高い信号では(この場合、公称電力レベルがフルスケールより少なくとも6dB～8dB小さくなります)、これらの変換器の使用の影響は小さくなります。

この例のトランスは使用される信号に適切な終端回路で終端することができます。低い電圧の差動信号が考えられる場合は、1:4のインピーダンス比のトランスの使用が望ましいでしょう。差動信号が別のプレーンから来る場合、センタータップをADCに近いコンデンサを介してグランドにバイパスすることができます。コンデンサを入力に使用するとピーキングが生じることがあり、伝送ラインの長さに依存して、 $10\Omega \sim 20\Omega$ の直列抵抗が必要になることがあります。この抵抗は、近傍のデジタル信号によってクロック・ラインに誘起されることがある高周波ノイズに対するローパス・フィルタおよび反射に対する減衰メカニズムの両方として機能します。

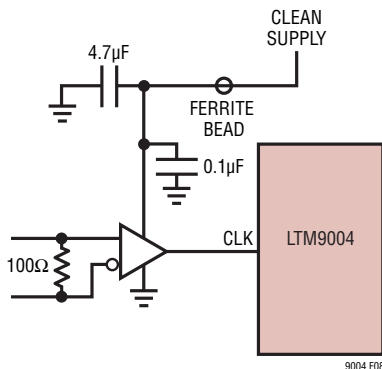


図8. LVDSまたはPECLからCMOSへの変換器を使ったCLKドライバ

最大変換レートと最小変換レート

ADCの最大変換レートは125Mspsです。サンプリング・レートの下限はサンプル&ホールド回路の垂下によって決まります。このADCのパイプライン・アーキテクチャでは、アナログ信号を小容量のコンデンサに保存します。接合部のリーク電流によりコンデンサが放電します。LTM9004の規定最小動作周波数は1Mspsです。

クロック・デューティ・サイクル・スタビライザ

入力クロックのデューティ・サイクルが50%でなくても、オプションのクロック・デューティ・サイクル・スタビライザ回路により確実に高性能が得られます。ほとんどのアプリケーションにはクロック・デューティ・サイクル・スタビライザの使用を推奨します。クロック・デューティ・サイクル・スタビライザを使うには、外付け抵抗を使ってMODEピンを $1/3V_{DD}$ または $2/3V_{DD}$ に接続します。

この回路はCLKピンの立ち上がりエッジを使ってアナログ入力をサンプリングします。CLKの立ち下がりエッジは無視され、フェーズロック・ループにより内部で立ち下がりエッジが作られます。入力クロックのデューティ・サイクルは40%～60%の範囲で変化することができ、クロック・デューティ・サイクル・スタビライザは内部デューティ・サイクルを50%に保ちます。クロックが長時間オフすると、デューティ・サイクル・スタビライザ回路のPLLが入力クロックにロックするのに100クロック・サイクルが必要です。

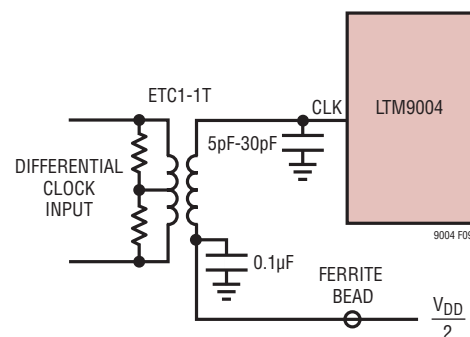


図9. トランスを使ったLVDSまたはPECLのCLKドライブ

アプリケーション情報

サンプル・レートを即座に変更する必要があるアプリケーションでは、クロック・デューティ・サイクル・スタビライザをディスエーブルすることができます。デューティ・サイクル・スタビライザをディスエーブルする場合、サンプリング・クロックのデューティ・サイクルが50% (±5%) になるように注意してください。

デジタル出力

アナログ入力電圧、デジタル・データ・ビット、およびオーバーフロー・ビットの相互関係を表3に示します。チャンネルIまたはチャンネルQにオーバーフローまたはアンダーフローが生じるとOFが“H”になることに注意してください。

表3. 出力コードと入力電圧

入力	OF	D13～D0 (オフセット・バイナリ)	D13～D0 (2の補数)
過電圧	1	11 1111 1111 1111	01 1111 1111 1111
最大	0	11 1111 1111 1111	01 1111 1111 1111
	0	11 1111 1111 1110	01 1111 1111 1110
	0	10 0000 0000 0001	00 0000 0000 0001
	0	10 0000 0000 0000	00 0000 0000 0000
	0	01 1111 1111 1111	11 1111 1111 1111
	0	01 1111 1111 1110	11 1111 1111 1110
最小	0	00 0000 0000 0001	10 0000 0000 0001
	0	00 0000 0000 0000	10 0000 0000 0000
低電圧	1	00 0000 0000 0000	10 0000 0000 0000

デジタル出力モード

1個の出力バッファの等価回路を図10に示します。各バッファはOV_{DD}とOGNDから給電され、ADCの電源とグランドからは分離されています。出力ドライバにNチャネル・トランジスタが追加されているので低電圧まで動作可能です。出力に直列接続された内部抵抗により、外部回路から見ると出力は50Ωに見えるので、外部の減衰抵抗が不要です。

全ての高速高分解能コンバータの場合と同様、デジタル出力負荷が性能に影響を与えることがあります。デジタル出力と敏感な入力回路の間に生じるおそれのある相互反応を抑えるため、ADCのデジタル出力はできるだけ小さな容量性負荷をドライブするようにします。全速動作では負荷の容量は10pF以下に抑えます。

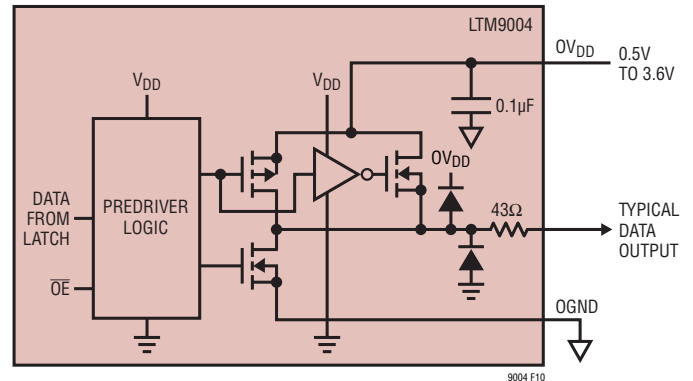


図10. デジタル出力バッファ

OV_{DD} 電圧を低くすることも、デジタル出力からの干渉を減らすのに役立ちます。

データのフォーマット

ADCの平行・デジタル出力は、MODEピンを使って、オフセット・バイナリ形式または2の補数形式に設定できます。MODEはIとQの両方のチャンネルをコントロールすることに注意してください。MODEをGNDまたは1/3V_{DD}に接続するとストレート・バイナリの出力フォーマットが選択されます。MODEを2/3V_{DD}またはV_{DD}に接続すると2の補数の出力フォーマットが選択されます。外部抵抗分割器を使って1/3V_{DD}または2/3V_{DD}のロジック値を設定することができます。MODEピンのロジック状態を表4に示します。

表4. MODEピンの機能

MODEピン	出力フォーマット	クロック・デューティ・サイクル・スタビライザ
0	ストレート・バイナリ	オフ
1/3V _{DD}	ストレート・バイナリ	オン
2/3V _{DD}	2の補数	オン
V _{DD}	2の補数	オフ

オーバーフロー・ビット

OFがロジック“H”を出力しているとき、コンバータのIチャンネルまたはQチャンネルにオーバーレンジまたはアンダーレンジが生じています。両方のチャンネルは共通のOFピンを共有していることに注意してください。Iチャンネルがスリープ・モードまたはナップ・モードのとき、OFはディスエーブルされます。

アプリケーション情報

出力クロック

ADCにはCLKQ入力を遅延させた信号がデジタル出力 (CLKOUT)として備わっています。CLKOUTピンの立ち下がリエッジを使ってデジタル出力データをラッチすることができます。チャンネルQがスリープ・モードまたはナップ・モードのとき、CLKOUTはディスエーブルされます。

出力ドライバの電源

出力専用の電源ピンとグランド・ピンが備わっているので、出力ドライバをアナログ回路から分離することができます。デジタル出力バッファの電源 (OV_{DD}) は、ドライブされるロジックに給電しているのと同じ電源に接続します。たとえば、1.8V電源から給電されているDSPをコンバータがドライブする場合、OV_{DD}を同じ1.8V電源に接続します。

OV_{DD}は500mVからデバイスのV_{DD}までの任意の電圧で電力供給を受けることができます。OGNDはGND～1Vの任意の電圧で電力供給を受けることができ、OV_{DD}より低くなければなりません。ロジック出力はOGNDとOV_{DD}の間で振幅します。

出力イネーブル

出力イネーブル・ピン (OE) を使って出力をディスエーブルすることができます。OEを“H”にすると、OFを含む全てのデータ出力がディスエーブルされます。データのアクセス時間やバスの解放時間は、全速動作時に出力をイネーブルまたはディスエーブルするには遅すぎます。出力のHi-Z状態は長期の休止時に使うことを意図しています。チャンネルIとチャンネルQには独立した出力イネーブル・ピン (OE_I、OE_Q) が備わっています。

デジタル出力のマルチプレクサ

ADCのデジタル出力は1本のデータバスに多重化することができます。MUXピンは2本のデータバスを交換するデジタル入力です。MUXが“H”だと、IチャンネルはDI0～DI13から出力し、QチャンネルはDQ0～DQ13から出力します。MUXが“L”だと出力バスが入れ替わり、IチャンネルはDQ0～DQ13から出力し、QチャンネルはDI0～DI13から出力します。両方のチャンネルを1本の出力バスに多重化するにはMUX、CLKIおよびCLKQと一緒に結合します (多重モードの「タイミング図」を参照)。多重化されたデータはどちらのデータバスでも利用できます (使用しないデータバスは対応するOEピンを使ってディスエーブルすることができます)。

設計例 – UMTS アップリンクのFDDシステム

LTM9004をRFフロントエンドと組み合わせて、UMTSバンドのアップリンク・レシーバを構築することができます。RFフロントエンドは、ダイプレクサ、1個または複数のLNAおよびバンドパス・フィルタで構成されます。次に示すのはこのようなフロントエンドの標準的性能の一例です。

Rx 周波数範囲:	1920～1980 MHz
RF利得:	最大 15dB
AGCの利得:	20dB
ノイズフィギュア:	1.6dB
IIP2:	50dBm
IIP3:	0dBm
P1dB:	–9.5dBm
20MHzでの除去:	2dB
Txバンドでの除去:	95dB

レシーバの最小性能については、3GPP TS25.104 V7.4.0仕様に詳細が示されています。この例では、動作バンドIの中域基地局を使います。

レシーバでは、感度は主要な検討事項です。その要件は、–19.8dB/5MHzの入力SNRに対して≤–111dBmです。つまり、レシーバの入力のところの実効ノイズフロアは≤–158.2dBm/Hzである必要があります。RFフロントエンドの実効ノイズの寄与分がこのように与えられると、LTM9004による最大許容ノイズは–142.2dBm/Hzである必要があります。LTM9004の標準入力ノイズは–148.3dBm/Hzであり、これに基づいて計算するとシステムの感度は–116.7dBmとなります。

一般に、このようなレシーバは、ADCの後に置かれるデジタル化信号のDSPフィルタの恩恵を受けます。この場合、DSPフィルタは、アルファが0.22の64タップRRCローパスであると仮定します。コチャネル干渉信号が存在する状態で動作するには、レシーバに最大感度で十分なダイナミックレンジがなければなりません。UMTS仕様は、–73dBmの最大コチャネル干渉信号を要求しています。LTM9004のIFパスバンド内の–1dBFSの入力レベルは、波高係数が10dBの変調信号では–15.1dBmであることに注意してください。トーン干渉信号は–42.6dBFSのピーク・デジタル化信号レベルに相当します。

アプリケーション情報

RF AGCが最小利得に設定されている状態で、レシーバはハンドセットからの予期される最大信号を復調できる必要があります。この要件は、LTM9004が-1dBFS以下で対応する必要のある最大信号を最終的に設定します。ハンドセットの+28dBmの平均電力を仮定すると、仕様で要求される最小経路損失は53dBです。すると、最大信号レベルはレシーバの入力では-25dBm、LTM9004の入力では-30dBmです。これは-14.6dBFSのピークに相当します。

UMTSのシステム仕様で詳細に説明されているいくつかのブロッカ信号があります。これらの信号が存在すると、感度が-105dBm以下に劣化することがあります。これらの最初のものは5MHz離れた隣接チャンネルであり、-42dBmのレベルです。これは-11.6dBFSのピーク・デジタル化信号レベルに相当します。その結果得られる感度は-112.8dBmです。

レシーバは10MHz以上離れた-35dBmの干渉チャンネルにも対抗する必要があります。RFフロントエンドはこのチャンネルの除去を行わないので、-6.6dBFSのピークとなり、その結果感度は-109.2dBmになります。

バンド外のブロッカにも対処する必要がありますが、これらは既に対処済みのバンド内のブロッカと同じレベルです。

これら全ての場合に、LTM9004の標準-1dBFSの入力レベルは予期される最大信号レベルを十分上回っています。変調されたチャンネルの波高率は10dB～12dB程度になるので、これらの最大のものはモジュールの出力で約-6.5dBFSのピーク電力に達することに注意してください。

最大ブロッカ信号は、受信帯域端を超える20MHz以上のCWトーンで-15dBmです。RFフロントエンドはこのトーンの37dBの除去を行うので、LTM9004の入力で-32dBmになります。この場合も、このレベルの信号はベースバンド・モジュールの感度を下げることはありません。相当するデジタル化レベルはわずか-41.6dBFS（ピーク）なので、感度に対する影響はありません。

望ましくない信号電力の別のソースはトランスミッタからのリーク電力です。これはFDDアプリケーションなので、ここで説明されているレシーバは同時に動作しているトランスミッタと結合されます。トランスミッタの出力レベルは+38dBm以下であり、送信と受信の分離は95dBであると想定しています。したがって、LTM9004の入力に現れるリーク電力は-42dBmで、

受信信号から少なくとも130MHzオフセットされています。相当するデジタル化レベルはわずか-76.6dBFS（ピーク）なので、感度の低下はありません。

直接変換アーキテクチャの課題の1つは2次直線性です。2次直線性が不十分だと、（要不要に関係なく）どんな信号もDCオフセットやベースバンドの疑似ランダム・ノイズを生じます。上で説明されているブロッカ信号は、この疑似ランダム・ノイズがレシーバのノイズレベルに近づくと、感度を低下させます。システムの仕様は、それぞれの場合にこれらのブロッカが存在するときの感度の低下を許容します。システムの仕様によれば、-35dBmのブロッカ・チャンネルは感度を-105dBmに低下させることができます。これは、レシーバの実効入力ノイズを-148.2dBm/Hzに増加させることに相当します。LTM9004の入力によって生じる2次歪みはこのレベルより約18dB下であり、その結果予想される感度は-116.6dBmです。

-15dBmのCWブロッカは2次積も増加させます。この場合、この積はDCオフセットです。DCオフセットはA/Dコンバータが処理できる最大信号を減少させるので、望ましくありません。DCオフセットの影響を緩和する確実な方法の1つは、ベースバンド・モジュールの2次直線性を十分高くすることです。この信号による予測DCオフセットは、ADCの入力のところで1mV未満です。

トランスミッタのリーク電流はシステムの仕様に含まれていないので、この信号による感度の劣化を最小に抑える必要があることに注意してください。LTM9004内で生じる2次歪は、感度が0.1dB未満になる程度です。

仕様の3次直線性には1つの要件しかありません。2つの干渉信号がある場合、感度は-105dBmより下にはなりません。干渉信号は、それぞれ-44dBmのCWトーンおよびWCDMAチャンネルです。これらはLTM9004の入力のところにそれぞれ-29dBmで現れます。それらの周波数は望みの周波数から10MHzおよび20MHz離れているので、3次相互変調積はベースバンドになります。この場合も、この積は疑似ランダムノイズとして現れるので、信号対ノイズ比を下げます。したがって、-105dBmの感度では、レシーバの入力を基準にした許容3次歪みは-148.2dBm/Hzです。LTM9004で生じる3次歪みはこのレベルより約23dB下であり、予測される感度の劣化は0.1dB未満です。

アプリケーション情報

電源シーケンシング

V_{CC}ピンはミキサと全てのアンプに電源を与え、V_{DD}ピンはADCに電源を与えます。ミキサ、アンプおよびADCはLTM9004内の別個の集積回路です。ただし、標準的なやり方以外の電源シーケンシングは考慮されていません。

接地とバイパス

LTM9004には全く切れ目の無いグラウンド・プレーンを備えたプリント基板が必要です。内部グラウンド・プレーンを備えた多層基板を推奨します。LTM9004のピン配置はフロースルー・レイアウトに最適化されているので、入力とデジタル出力間の相互反応が最小に抑えられます。一列に連続したグラウンド・パッドによりレイアウトが簡単になり、デジタル信号ラインとアナログ信号ラインをできるだけ分離することができます。

LTM9004は内部でバイパスされており、ADC (V_{DD})、ミキサおよびアンプ (V_{CC}) の各電源は共通グラウンド (GND) に戻ります。デジタル出力電源 (OV_{DD}) はOGNDに戻ります。0.1μFのバイパス・コンデンサを2つのOV_{DD}ピンのそれぞれに接続します。追加のバイパス・コンデンサはオプションで、電源ノイズが大きいと必要になることがあります。

熱伝達

LTM9004が発生する熱の大部分は底面のグラウンド・パッドを通して伝わります。電気的性能と熱的性能を良くするには、全てのグラウンド・ピンを面積が十分大きなグラウンド・プレーンにできるだけ多くのビアを使って接続することが重要です。

推奨レイアウト

LTM9004は高度に一体化されているので、PCBボードのレイアウトが非常に簡単です。ただし、電気的性能と熱的性能を最適化するにはいくつかのレイアウト上の配慮が依然として必要です。

- グラウンドにはPCBの大きな銅領域を使用します。これにより基板を通してパッケージ内部の熱が放散するのが助けられ、基板上の敏感なアナログ信号をシールドするのも役立ちます。共通グラウンド (GND) と出力グラウンド (OGND) はLTM9004では電氣的に絶縁されていますが、PCB上でデバイスの下で接続して共通リターン経路を与えることができます。
- 複数のグラウンド・ビアを使います。できるだけ多くのビアを使うと、基板の熱性能を改善するのに役立ち、基板上のアナログ・トレースとデジタル・トレースを高周波数で分離するのに必要なバリヤを形成します。
- ビアを使って高周波バリヤを作って、アナログ・トレースとデジタル・トレースをできるだけ分離します。これにより、LTM9004の信号対雑音比 (SNR) とダイナミックレンジを下げる可能性のあるデジタル・フィードバックが減少します。

推奨レイアウトの良い例を図11～図14に示します。

ペースト印刷の品質は、高歩留りアセンブリにとって重要な要素です。タイプ3またはタイプ4を使って無洗浄半田ペーストを印刷することを推奨します。半田ステンシルは「アプリケーションノート100」で説明されているガイドラインに従ってデザインします。

LTM9004は鉛ベースまたは錫ベースの半田ペーストで使えるように金仕上げのパッドを採用しています。内部は鉛フリーで、JEDEC (e4) 標準規格に適合しています。材料表はhttp://www.linear.com/leadfree/mat_dec.jspからオンラインで入手できます。

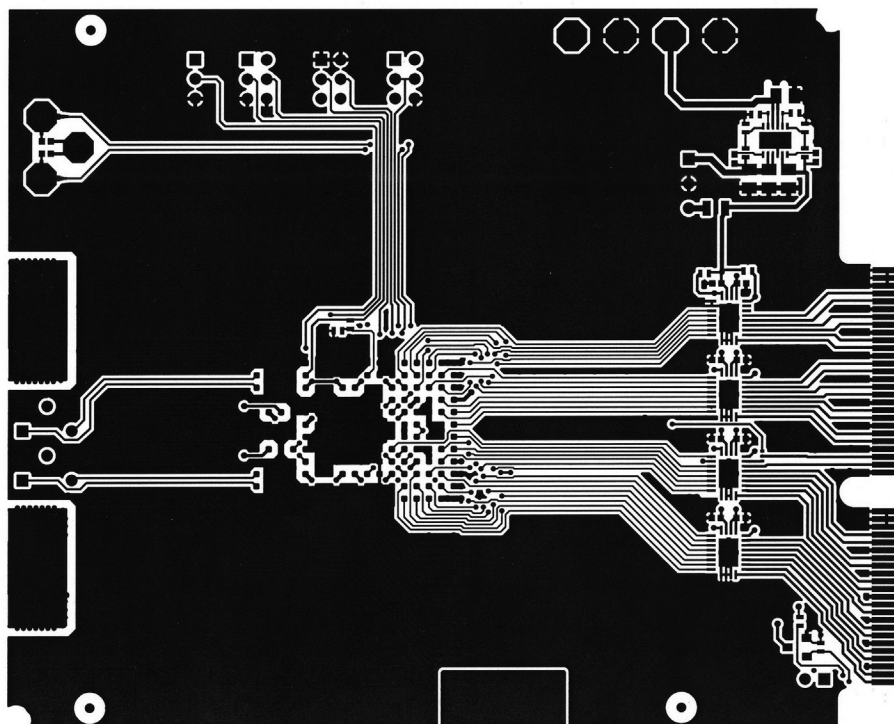


図 11. レイヤ1

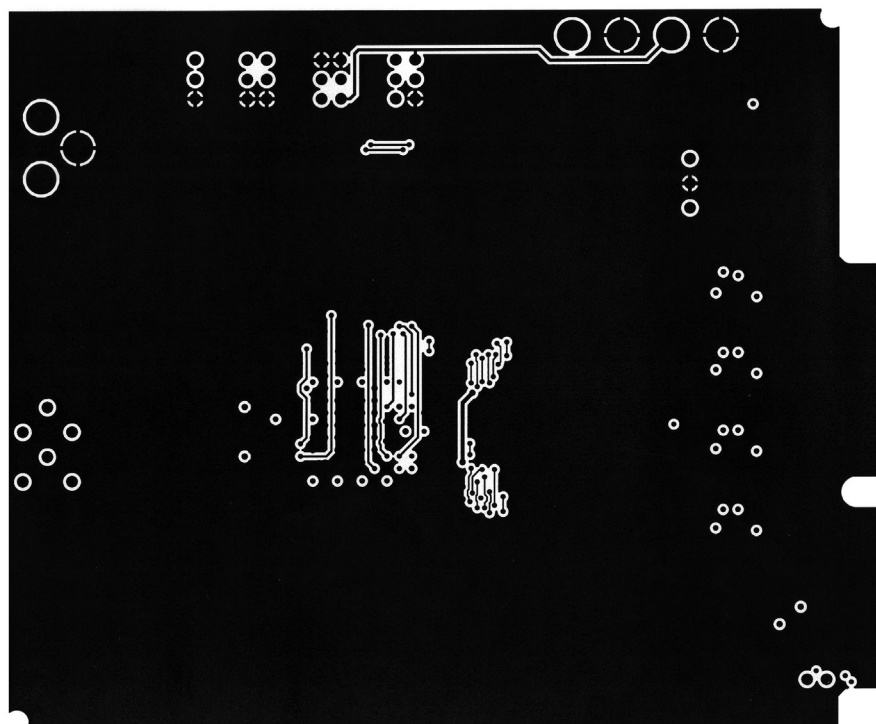


図 12. レイヤ2

アプリケーション情報

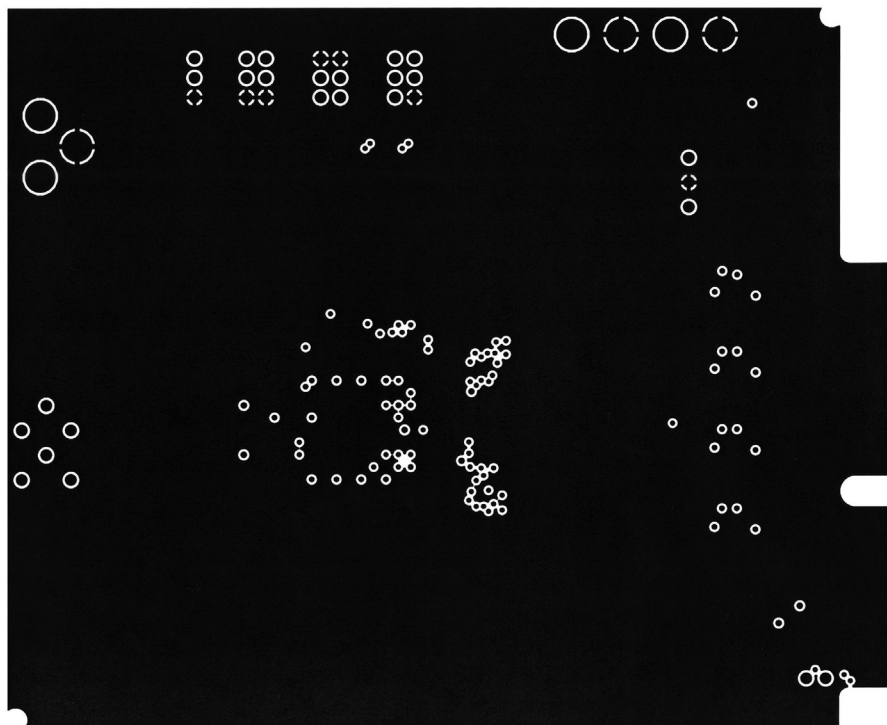


図 13. レイヤ3

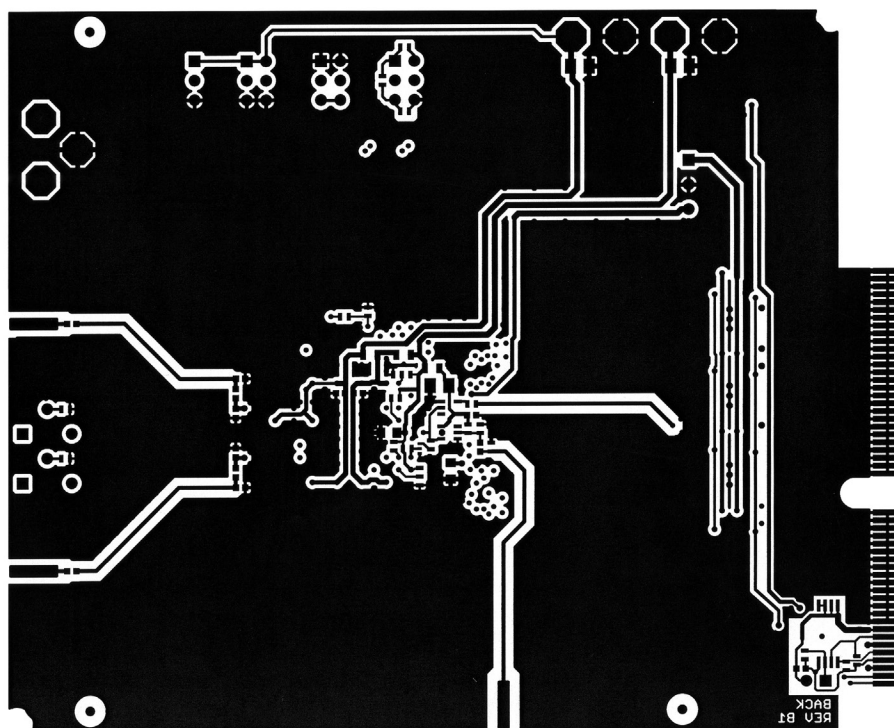
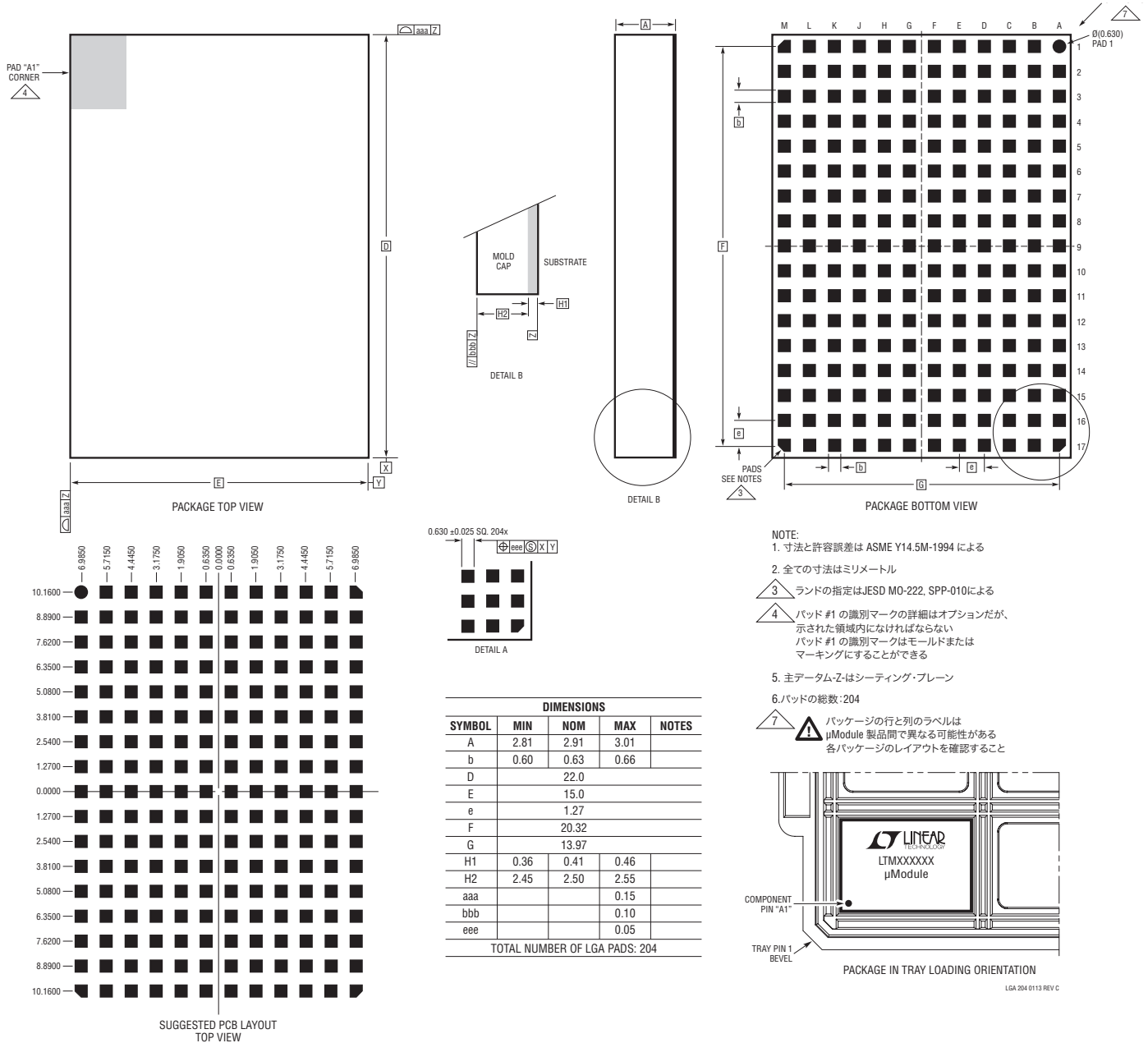


図 14. レイヤ4

パッケージ寸法

最新のパッケージ図面については、<http://www.linear-tech.co.jp/designtools/packaging/> をご覧ください。

LGA Package 204-Lead (22mm × 15mm × 2.91mm) (Reference LTC DWG # 05-08-1822 Rev C)

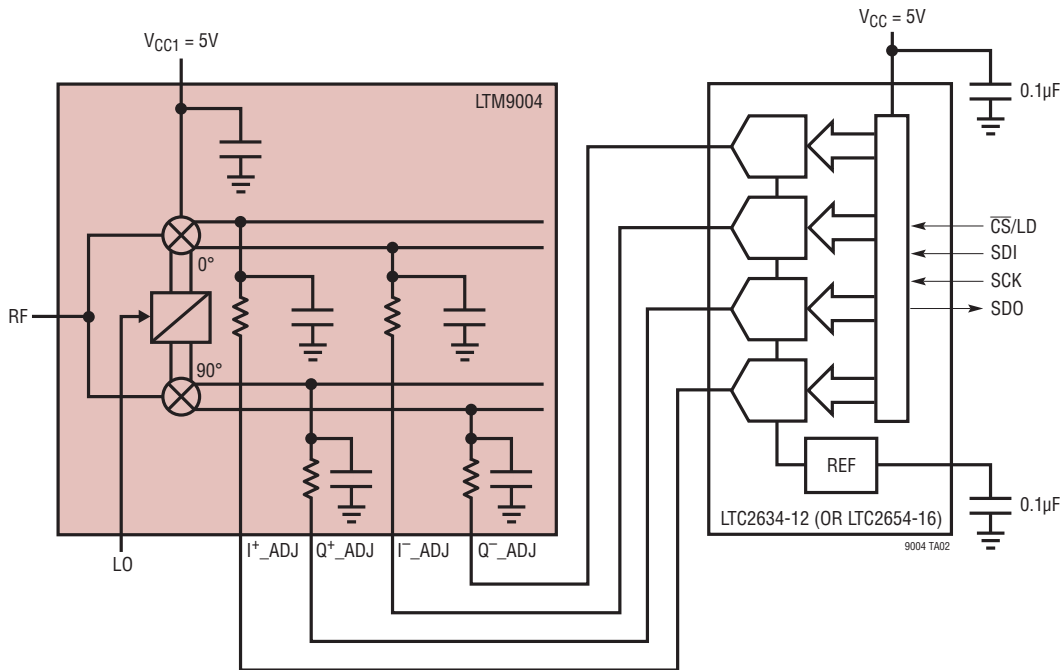


改訂履歴

Rev	日付	概要	ページ番号
A	5/14	パッケージ図を更新、高さを2.91mmに変更。	2、26

LTM9004

標準的応用例



関連製品

製品番号	概要	注釈
LTC2295	デュアルの14ビット、10Msps ADC	120mW、SNR:74.4dB、9mm×9mm QFN
LTC2296	デュアルの14ビット、25Msps ADC	150mW、SNR:74dB、9mm×9mm QFN
LTC2297	デュアルの14ビット、40Msps ADC	240mW、SNR:74dB、9mm×9mm QFN
LTC2298	デュアルの14ビット、65Msps ADC	410mW、SNR:74dB、9mm×9mm QFN
LTC2299	デュアルの14ビット、80Msps ADC	445mW、SNR:73dB、9mm×9mm QFN
LTC2284	デュアルの14ビット、105Msps ADC	540mW、SNR:72.4dB、SFDR:88dB、64ピンQFN
LTC2285	デュアルの14ビット、125Msps ADC	790mW、SNR:72.4dB、SFDR:88dB、64ピンQFN
LT5575	800MHz~2.7GHz 高直線性 直接変換直交復調器	IIP2:1.9GHzで60dBm、NF:12.7dB、低いDCオフセット
LTC6404-1/ LTC6404-2	600MHz、低ノイズ、高AC精度、 完全差動入出力アンプ/ドライバ	3Vまたは5V、1.5nV/√Hz、非常に低い歪み:-92dBc(10MHz)
LTC6406	3GHz 低ノイズ、レール・トゥ・レール 入力差動ADCドライバ	低ノイズ:1.6nV/√Hz、低消費電力:18µA
LTM9001	16ビット、IF/ ベースバンド・レシーバ・サブシステム	16ビットの130Msps ADCを内蔵、受動フィルタと固定利得の差動アンプ、 11.25mm×11.25mm LGAパッケージ
LTM9002	14ビット、デュアルチャネルIF/ ベースバンド・レシーバ・サブシステム	14ビットのデュアル125Msps ADCを内蔵、受動フィルタと固定利得の差動アンプ、 最大300MHzのIF範囲、15mm×11.25mm LGAパッケージ

9004fa